

簡式公開說明書

(發行一百年度第二期無擔保普通公司債申報用稿本)

一、本公開說明書編印目的：發行一百年度第二期無擔保普通公司債。

二、本次發行公司債之種類、金額、利率及發行條件：

(一) 種類：無擔保普通公司債。

(二) 金額：新台幣壹佰柒拾億元整。

(三) 利率：詳見發行條件 4.。

(四) 發行條件：

1. 名稱：台灣積體電路製造股份有限公司一百年度第二期無擔保普通公司債
(以下簡稱本公司債)。

2. 發行總額及面額：發行總額為新臺幣壹佰柒拾億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類兩種，甲類五年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣壹佰億元整、乙類七年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣柒拾億元整。票面金額均為新臺幣壹仟萬元整。

3. 發行期間及方式：甲類為五年期、乙類為七年期，發行期間分別如下：

甲類：自民國一〇一年一月[]日開始發行，至民國一〇六年一月[]日到期。

乙類：自民國一〇一年一月[]日開始發行，至民國一〇八年一月[]日到期。

本公司債於發行日依票面金額十足發行。

4. 票面利率：甲類：年利率 1.29%。乙類：年利率 1.46%。

5. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。本公司債付息金額每壹仟萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。

6. 還本方式：甲類五年期及乙類七年期均為到期一次還本。

7. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

8. 債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

(五) 公開承銷比例：不適用。

(六) 承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：詳見本說明書第 42 頁。

四、本次發行之相關費用：

(一) 承銷費用：不適用。

(二) 其他費用：約新台幣18,000仟元。

五、有價證券之生效不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項（詳見公開說明書第4頁）。

八、投資人查詢本公開說明書電子檔案之網址：公開資訊觀測站(<http://mops.tse.com.tw>)。

一、本次發行前實收資本額來源：詳本公開說明書第 19 頁

二、公開說明書之分送計畫

(一)陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構。

(二)分送及索取方式：請附小包裏郵資及信封袋向本公司索取或請透過網路取閱 (<http://newmops.twse.com.tw>)。

三、公司債承銷商：不適用。

四、公司債保證機構：不適用。

五、公司債受託機構：

名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司

地址：台北市吉林路100號11樓

電話：(02)2563-3156

網址：<https://www.megabank.com.tw>

六、公司債簽證機構：不適用

七、辦理公司債過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市中山區明水路700號9樓

電話：(02)2181-8888

網址：<http://www.kgi.com.tw>

八、公司債信用評等機構：

名稱：中華信用評等股份有限公司

地址：台北市信義路五段7號49樓

電話：(02)8722-5800

網址：<http://www.taiwanratings.com>

九、公司債簽證律師：

律師事務所名稱：現代律師事務所

簽證律師：郭惠吉

地址：台北市大安區新生南路二段82號3樓之一

電話：(02)2392-0628

網址：<http://modernlaw.myweb.hinet.net>

十、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林鴻鵬、黃樹傑

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市民生東路三段156號12樓

電話：(02)2545-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

十一、複核律師：不適用

十二、本公司發言人及代理發言人

發言人：何麗梅

職稱：資深副總經理暨財務長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

代理發言人：孫又文

職稱：企業訊息處處長

電子郵件：invest@tsmc.com

電話：(03)563-6688

十三、本公司網址：www.tsmc.com

台灣積體電路製造股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 259,141 百萬元		公司地址：新竹科學工業園區力行六路 8 號		電話：(03)5636688	
設立日期：76 年 2 月 21 日			網址：www.tsmc.com		
上市日期：83 年 9 月 5 日		上櫃日期：不適用		公開發行日期：81 年 10 月 30 日	
管理股票日期：不適用					
負責人：董事長 張忠謀		發言人：何麗梅 職稱：資深副總經理暨財務長		代理發言人：孫又文 職稱：企業訊息處處長	
公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司		電話：(02)2181-8888		網址： http://www.kgi.com.tw	
地址：台北市中山區明水路 700 號 9 樓					
公司債承銷機構：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
最近年度簽證會計師：林鴻鵬、黃樹傑		電話：(02)2545-9988		網址： http://www.deloitte.com.tw	
地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓					
複核律師：不適用		電話：不適用		網址：不適用	
地址：不適用					
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司		電話：(02) 8722-5800		網址： http://www.taiwanratings.com	
地址：臺北市信義路五段 7 號 49 樓					
最近一次經信用評等日期：100 年 12 月 6 日		評等標的： 本公司一百年度第二期無擔保普通公司債		評等結果：twAAA	
董事選任日期：98年6月，任期：3 年 100 年 6 月 9 日增選二名獨立董事			監察人選任日期：不適用		
全體董事持股比例：7.13%（100 年 9 月 30 日）			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股超 10%股東及其持股比例：(100 年 9 月 30 日)					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	備 註		
董事長	張忠謀	0.48%			
副董事長	曾繁城	0.13%			
董事	李鍾熙	6.38%	行政院國家發展基金管理會代表人		
董事	蔡力行	0.13%			
獨立董事	彼得·邦菲	-			
獨立董事	施振榮	0.01%			
獨立董事	湯馬斯·延吉布斯	-			
獨立董事	鄒至莊	-			
獨立董事	陳國慈	-			
工廠地址：	(二廠、五廠)	新竹科學工業園區園區三路121號	電話：(03)5636688		
	(三廠)	新竹科學工業園區研新一路9號	電話：(03)5636688		
	(六廠)	台南科學工業園區南科北路1號	電話：(06)5056688		
	(八廠)	新竹科學工業園區力行路25號	電話：(03)5636688		
	(十二廠)	新竹科學工業園區力行六路8號	電話：(03)5636688		
	(十四廠)	台南科學工業園區南科北路1號之1	電話：(06)5056688		
	(十五廠)	台中市大雅區科雅六路1號	電話：(04)27026688		
主要產品：積體電路及其他晶圓半導體裝置之製造與銷售				市場結構：內銷 13.2% 外銷 86.8%	
風 險 事 項 請參閱本公開說明書之公司概況二				參閱本文之頁次	
				24 頁	
風 險 事 項 請參閱本公開說明書之公司概況二				參閱本文之頁次	
				4 頁	

去（ 99 ）年度	營業收入：新台幣406,963佰萬元 買賣業： - 佰萬元 加工業： - 佰萬元 製造業：新台幣406,963佰萬元 稅前純益：新台幣 169,290 佰萬元	每股盈餘：6.24 元(稅後基本)	49 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	一百年度第二期無擔保普通公司債新台幣壹佰柒拾億元整		
發行條件	見公開說明書封面		
募集資金用途及預計產生效益概述	充實營運資金，效益請參閱公開說明書第 42 頁		
本次公開說明書刊印日期：100 年 12 月 21 日		刊印目的：發行一百年度第二期無擔保普通公司債	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄			

台灣積體電路製造股份有限公司
公開說明書目錄

目錄

壹、 公司概況	1
一、 公司簡介	1
(一) 設立日期	1
(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話	1
(三) 公司沿革	2
二、 風險事項	4
(一) 風險因素	4
(二) 訴訟或非訟事件	9
(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至 公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事	10
(四) 其他重要事項	11
三、 公司組織	12
(一) 關係企業圖	12
(二) 董事會成員簡介	14
四、 資本及股份	19
(一) 股本形成經過	19
(二) 主要股東名單	21
(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認 股之情形	21
(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	22
(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞	22
貳、 營運概況	23
一、 公司經營	23
(一) 業務內容	23
(二) 市場及產銷概況	33
二、 轉投資事業	36
(一) 轉投資事業概況	36
(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設 定質權情形	37
三、 重要契約	38

參、 發行計畫及執行情形	39
一、 本次發行公司債資金運用計畫分析	39
(一) 資金來源	39
(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款 項之籌集計畫與保管方法	39
(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來 一年每股盈餘稀釋影響	41
(四) 本次發行價格之訂定方式	42
(五) 資金運用概算及可能產生之效益	42
二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項	46
三、 本次併購發行新股應記載事項	46
肆、 財務概況	47
一、 財務分析	47
二、 財務報表應記載事項	48
(一) 最近二年度經會計師查核簽證之財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八 個月，加列上半年度財務報表)	48
(二) 最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表(申報募集發行有價證券已 逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表)	48
(三) 截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表	48
三、 財務概況應記載事項	48
四、 財務狀況及經營結果檢討分析	49
(一) 財務狀況	49
(二) 經營結果	49
(三) 現金流量	50
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	51
(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	51
(六) 其他重要事項	51
伍、 特別記載事項	51
一、 委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事 項改善情形	51
二、 委託經行政院金管會證券暨期貨管理局核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評 機構所出具之信用評等報告	51
三、 證券承銷商評估總結意見	51
四、 律師法律意見書	51
五、 由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	51

六、	本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經證期會通知應補充揭露之事項	51
七、	最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者	52
八、	公司治理運作情形	52
(一)	董事會運作情形	52
(二)	審計委員會運作情形	53
(三)	公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	55
(四)	薪酬委員會運作情形	58
(五)	履行社會責任情形	58
(六)	公司履行誠信經營情形及採行措施	65
(七)	公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式	65
(八)	最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總	65
(九)	其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊	65

壹、公司概況

一、公司簡介

(一) 設立日期

民國76年2月21日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

公司總部及晶圓十二廠

300-78新竹科學工業園區力行六路8號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5637000

晶圓二廠、五廠

300-77新竹科學工業園區園區三路121號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781546

晶圓三廠

300-77新竹科學工業園區研新一路9號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5781548

晶圓六廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5052057

晶圓八廠

300-78新竹科學工業園區力行路25號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5662051

晶圓十四廠

741-44台南科學工業園區南科北路1號之1

電話：886-6-5056688 傳真：886-6-5051262

晶圓十五廠

428-82台中市大雅區科雅六路1號

電話：886-4-27026688 傳真：886-4-25607548

北美子公司

2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134, U.S.A.

電話：408-3828000 傳真：408-3828008

歐洲子公司

World Trade Center, Zuidplein 60, 1077 XV Amsterdam

The Netherlands

電話：31-20-3059900 傳真：31-20-3059911

日本子公司

21F, Queen' s Tower C, 2-3-5, Minatomirai, Nishi-ku

Yokohama, Kanagawa, 220-6221, Japan

電話：81-45-6820670 傳真：81-45-6820673

台積電（中國）有限公司

上海市松江區文翔路4000號

郵政編碼：201616

電話：86-21-57768000 傳真：86-21-57762525

台積電韓國有限會社

15F, AnnJay Tower, 718-2, Yeoksam-dong, Gangnam-gu

Seoul 135-080, Korea

電話：82-2-20511688 傳真：82-2-20511669

印度聯絡處

1st Floor, Pine Valley, Embassy Golf-Links Business Park

Bangalore-560071, India

電話：91-80-41768615 傳真：91-80-41764568

加拿大子公司

535 Legget Dr, Suite 600, Kanata, ON K2K 3B8, Canada

電話：1-613-576-1990 傳真：1-613-576-1999

固態照明子公司

300-78新竹科學工業園區力行四路9號

電話：886-3-5636688 傳真：886-3-5679610

太陽能子公司

428-82台中市大雅區科雅西路5號

電話：886-4-27036699 傳真：886-4-25693884

(三) 公司沿革

台積公司成立於民國七十六年二月二十一日，總部設立於台灣新竹科學工業園區，是全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。

台積公司的客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。民國九十九年，台積公司所擁有及管理的產能達到 1,133 萬片八吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有三座先進的十二吋晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有二家海外子公司 WaferTech(美國)、台積電(中國)有限公司及其他轉投資公司之八吋晶圓廠產能支援。台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

1、歷史沿革

民國七十六年公司初創之時，向工研院租用一六吋晶圓廠，成為當初台積公司晶圓一廠；民國七十七年，台積公司於美國成立北美子公司；民國七十九年，台積公司晶圓二廠落成啟用；民國八十二年，於荷蘭成立歐洲子公司；民國八十三年，台積公司股票於台灣證券交易所掛牌上市；民國八十四年，首座八吋晶圓廠一晶圓三廠落成啟用，同年於美國設立 Wafertech 公司及晶圓廠；民國八十六年，美國存託憑證於紐約證券交易所掛牌上市，同年晶圓四廠、五廠落成啟用，亦設立日本子公司；民國八十七年，於新加坡與荷商飛利浦公司 (Philips) 合資設立 SSMC 公司與晶圓廠；民國八十九年，首座位於台南科學園區的晶圓六廠落成啟用；民國九十年，完成合併德基公司並命名為晶圓七廠、完成合併世大公司並命名為晶圓八廠，同年首座十二吋晶圓廠一晶圓十二廠落成啟用；民國九十一年，晶圓三、四廠重組並統稱為晶圓三廠；民國九十二年，於上海設立上海子公司及晶圓廠；民國九十三年，第二座十二吋晶圓廠一晶圓十四廠於南科落成啟用，同年上海晶圓廠亦落成啟用。民國一百年，第三座十二吋晶圓廠一晶圓十

五廠於中科落成啟用。

2、最近五年度及截至公開說明書刊印日止重要廠房之擴充及新技術之推出

最近五年台積公司持續擴建位於新竹的晶圓十二廠及位於台南的晶圓十四廠的廠房及產能，民國九十九年，這二座超大晶圓廠的總產能已達到 252 萬片十二吋晶圓，目前提供 0.13 微米、90 奈米、65 奈米、40 奈米、28 奈米全世代以及其半世代設計的生產，並保留部分產能作為研發用途，以支援 20 奈米、14 奈米及更先進製程的技術發展。台積公司座落於中部科學園區的第三座十二吋超大晶圓廠—晶圓十五廠，也於民國一百年第二季開始進行裝機，並持續擴建中。

民國九十五年，台積公司 65 奈米製程技術領先量產，並已通過產品驗證；並提供領先業界的 45 奈米晶圓共乘服務；此外，除了一般邏輯製程技術，台積公司亦針對客戶需求提供廣泛的技術服務，例如非揮發性嵌入式記憶體 (Embedded Non-volatile Memory) 製程技術、嵌入式動態隨機存取記憶體 (Embedded DRAM) 製程技術、混合訊號／射頻 (Mixed Signal/RF) 製程技術、高壓 (High Voltage) 製程技術、互補式金氧半導體影像感應處理器 (CMOS Image Sensor)、彩色濾光片 (Color Filter)、矽鍺 (Silicon Germanium) 製程技術等。

民國九十六年，台積公司開發及推出新製程技術如下：32 奈米先進製程與通過功能驗證的靜態隨機存取記憶體 (SRAM) 技術、45 奈米先進製程、由 65 奈米製程直接微縮 90% 的 55 奈米先進製程、65 奈米混合信號及射頻 (MS/RF) 先進製程、65 奈米嵌入式動態隨機存取記憶體 (Embedded DRAM) 先進製程、0.13 微米嵌入式快閃記憶體 (Embedded Flash) 製程、用於小面板單一驅動晶片的 0.16 微米高壓製程、用於大面板源極驅動晶片 (Source Drivers) 的 0.20 微米製程、0.25 微米雙載子互補元件 (Bipolar Complementary Device; BCD) 製程、1.00 微米超高壓製程。

民國九十七年，台積公司成為全球第一家將 40 奈米先進製程技術導入量產的專業積體電路製造服務業者。同時，領先專業積體電路製造服務領域，成功示範第一個能同時支援類比及數位積體電路的 32/28 奈米高介電層／金屬閘製程技術。此外，台積公司持續領先專業積體電路製造服務領域推出高效能 (N40G) 和低耗電 (N40LP) 的 40 奈米製程技術，並通過產品驗證。

民國九十八年，繼先前宣佈 28 奈米全世代高效能高介電層／金屬閘 (簡稱 28HP) 以及低耗電氮氧化矽 (簡稱 28LP) 製程技術的推出時程計劃之後，台積公司新增 28 奈米低耗電高介電層／金屬閘 (簡稱 28HPL) 製程，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。民國九十八年十二月，台積公司於中國大陸宣佈汽車業界第一個車用電子製程驗證規格 (Automotive Process Qualification Specification) 及符合車用電子等級的半導體製造套裝服務 (Automotive Service Package)。台積公司位於台灣的多個晶圓廠以及在上海的晶圓十廠皆已具備生產車用電子等級的積體電路產品的能力。

民國九十九年，台積公司宣佈提供 28 奈米全世代製程技術，包括支援高效能表現的 28 奈米高效能高介電層／金屬閘 (簡稱 28HP) 以及 28 奈米高效能行動運算製程技術 (簡稱 28HPM) 製程外，亦提供支援低耗電表現的 28 奈米低耗電氮氧化矽 (簡稱 28LP) 製程技術及 28 奈米低耗電高介電層／

金屬閘（簡稱 28HPL）技術，提供客戶更完備的 28 奈米製程技術選擇。

民國一百年，台積公司在開放創新平台(Open Innovation Platform™)上，建構完成 28 奈米設計生態環境，同時客戶採用台積公司開放創新平台所規劃的 28 奈米新產品設計定案(tape out)數量已經達到 89 個。

民國九十九年，台積公司投資固態照明及太陽能相關的二項新事業。民國一百年六月，台積公司股東會決議，核准將太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與兩家新設且由本公司百分之百持有之台積太陽能股份有限公司及台積固態照明股份有限公司，並以民國一百年八月一日為分割基準日。

3、最近五年度及截至公開說明書刊印日止經營權之改變

民國九十八年六月十二日，張忠謀董事長重新兼任總執行長一職。

4、最近五年度及截至公開說明書刊印日止董事或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換

民國九十六年三月九日台積公司和飛利浦公司共同宣佈雙方就飛利浦公司逐步有秩序地釋出台積公司持股事宜，規劃出多階段釋股方案，包括：飛利浦公司將在台灣證券集中交易市場透過一次或多次的鉅額交易釋出股份、將台積普通股轉換發行美國存託憑證出售、並於民國九十六年至九十九年間，於台積公司執行公司股份買回時參與應賣。

此釋股方案的第一階段於民國九十六年三月十二日執行完成，飛利浦公司於台灣證券交易市場透過鉅額交易之方式，將市值約 17 億 5,000 萬美元的台積公司普通股股份售予國內數家法人機構。第二階段於民國九十六年五月十八日執行完成，飛利浦公司將所持有市值約 25 億 6,000 萬美元之本公司普通股，轉換發行為美國存託憑證出售。

第三階段於民國九十六年十一月十四日至民國九十六年十二月三十一日執行完成，台積公司總計在集中交易市場買回 8 億股之普通股股票，總金額約美金 15 億元，隨後並將買回之股份辦理註銷。飛利浦公司亦於台積公司執行買回公司股份期間，同時在集中交易市場上出售 8 億股台積公司普通股股票。

第四階段於民國九十七年五月十四日至六月三十日之期間及民國九十七年八月十四日執行完畢，飛利浦公司透過集中市場出售及巨額交易的方式將剩餘的 5.1%持股售出，完成釋股。

二、風險事項

(一) 風險因素

1、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

■ 利率變動

台積公司的利率風險，主要來自為支應營運活動所產生之負債。為降低利率風險，台積公司主要以營運現金收入，及偶而發行固定利率的長期負債來滿足資金上的需求。在資產方面，台積公司主要投資於高流動性之短期固定收益債券，以保障本金安全及維持流動性。

■ 匯率變動

台積公司超過一半以上的資本支出及製造成本以非新台幣貨幣，如美元、日圓及歐元支付。此外，台積公司超過90%之營收來自美元及其他貨幣。因此，任何顯著而不利的國際匯率變動對台積公司財務狀況均可能會有不利影響，例如，民國九十九年九月一日至民國九十九年十二月三十一日期間，新台幣對美元升值達8.97%，即對台積公司帶來負面的影響，新台幣對美元每升值1%，即會使台積公司的營業利益率下降0.4個百分點。台積公司主要使用換匯換利交易及遠期外匯合約，以降低由資產與負債所產生的匯率風險。此外，由於營收成長強勁，避險需求亦同步成長，因此新增外幣短期借款，做為外匯避險的工具之一。

此外，新台幣對美元的匯率變化也可能會對台積公司普通股股價轉換成以美元表示後之數值、美國存託憑證之股價及現金股利轉換成美元後之數值產生影響。

■ 通貨膨脹及通貨緊縮

本公司最主要之外銷市場為北美市場，台積公司不認為中華民國及北美之通貨膨脹或通貨緊縮對本公司民國九十九年及民國一百零三年前三季之營運結果有重大之衝擊。但本公司無法保證，未來通貨膨脹或通貨緊縮在其性質、程度或範圍上不會有重大變化，而對本公司之營運結果產生重大不利之影響。

2、從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

自民國九十九年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未從事高風險／高槓桿的財務投資，也未為他人提供背書保證。本公司與海外子公司及本公司之子公司間之資金貸與均符合相關法令，並依相關規定辦理。

為了控管財務交易風險，台積公司已依據證期局的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

台積公司所從事的衍生性金融商品交易均是以避險為目的，而不是交易或投機性之操作。有關交易細節，請參考本公司民國九十九年年報及民國一百零三年第三季財務報表。

3、未來研發計畫及預計投入之研發費用

延續民國九十九年在先進技術研發上締造的優異成果，台積公司未來將繼續擴展其研發投資，並進一步擴充十二吋晶圓研發試產線，以加速 28 奈米製程的量產擴增，和 20 奈米製程的研發工作。此外，也將進一步強化前瞻性技術研究，繼續研發新的電晶體及製程技術，例如 3D 結構、應變層

(Strained-layer) 互補金屬氧化物半導體、高載子移動率材料以及創新的 3D 直通矽晶穿孔封裝與中介轉接層晶片技術平台等。目前，奈米級電晶體的基本物理和其特性的研究是台積公司研發的重點工作之一，以作為了解及引導未來先進製程元件的設計方向。台積公司已經運用相關的研發成果，確保台積公司在 28 奈米和 20 奈米製程技術世代的領先地位。台積公司的目標之一，是藉由內部的創新來延伸摩爾定律，同時也與產業領導者

及學術界共同合作，尋求具有成本效益的製程技術及製造解決方案。

台積公司將繼續與國際聯盟組織及光學微影設備供應商合作，確保能夠即時進行 193 奈米波長高數值孔隙 (NA) 掃描機技術、極紫外線 (EUV) 微影技術以及多重電子束投影技術的開發，以支援 20 奈米、14 奈米及更先進技術的製程研發工作。

台積公司也將繼續與光罩檢測設備供應商合作，共同開發先進的光罩檢測技術，以維持在光罩品質及交貨週期上的領導地位，並滿足研發、產品試製及生產的高標準要求。

台積公司擁有優異、高度專注的研發團隊，加上對創新的承諾，我們深信一定能提供客戶最具競爭優勢且最具成本效益的系統單晶片製程技術，來支援台積公司的營運成長及獲利能力。

計劃名稱	計劃內容	預計生產時程
28 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的 28 奈米製程技術	民國 99 年至民國 100 年
20 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的下一代製程技術	民國 101 年
14 奈米邏輯技術平台與應用	同時支援數位及類比產品應用的前瞻性製程技術	民國 103 年
3D 直通矽晶穿孔封裝晶片技術平台及應用	因應系統級封裝技術，開發更具成本效益以及更具尺寸、效能優勢的 3D 晶片	民國 101 年至民國 102 年
下一代微影技術	發展極紫外光微影技術和多重電子束技術，以延續摩爾定律	民國 100 年至民國 101 年
長期研發	開發特殊系統單晶片製程技術，包括新的非揮發性記憶體、微機電、射頻及類比晶片以及 14 奈米電晶體	民國 101 年至民國 103 年
上述計劃之研發經費約佔台積公司民國 100 年全年營收之 7~8%。		

4、國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

台積公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令，並訂定相關的風險管理程序。民國九十九年及至公開說明書刊印日止與本公司營運有關之重要法令變動如下：產業創新條例於民國九十九年五月制定，相關租稅減免措施較原促進產業升級條例限縮，台積公司將因此減少租稅優惠；配合上開條例之制定，所得稅法第五條亦於民國九十九年六月份配合修定，將營利事業所得稅率由 20%調降為 17%，台積公司亦將因此降低所得稅負。台積公司已充分考量上開稅法變動對經營成果之影響，並將做好各項相關財務控管。

行政院金融監督管理委員會要求上市公司自民國一百零二年一月一日起，須依國際會計準則 (IFRS) 編製財務報告，台積公司已成立專案小組負責推動，訂定採用 IFRS 之因應計劃暨預計執行進度，並定期將執行情形提報

公司董事會控管。採用 IFRS 的潛在影響可能包括改變部分交易的會計處理以及財務報告的表達方式，台積電將持續注意 IFRS 之增修及國內相關配套法令調整對公司之影響，並依規定於民國一百年度財務報告中，說明採用 IFRS 計劃之重要內容及執行情形，以及 IFRS 與現行會計政策之重大差異。

民國一百年一月二十六日修訂公布之全民健康保險法，修訂相關條文擴大保費費基，增加「補充保費」制。台積電未來發給員工分紅及非經常性給付之獎金時，需另負擔 2% 費率的補充保費。本法尚未經行政院公告施行日。台積電已充分考量此變動對經營成果之影響，並將做好各項相關財務控管。

此外，立法單位正在研議溫室氣體減量法及能源稅等環保相關法令，由於法令內容尚不確定，目前無法判斷相關法令通過後的具體影響，但有可能會增加公司營運成本。

除前述法令外，其他相關政策及法令的變化對台積電的財務及業務尚不會造成重大影響。

5、科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

■ 產業發展

半導體市場與微電子產業一向深受景氣循環、產品需求快速變化的影響，這樣的市場特性也對積體電路製造服務業產生衝擊。台積電的多數客戶均隸屬於上述產業，因此台積電的營收與獲利，也受到客戶下單波動的影響。

半導體產業與微電子產業不時面臨重大且持續不景氣及產能過剩的情況，台積電目前及未來業務需求皆來自這些產業客戶，上述產業不景氣及產能過剩將導致整體半導體製造服務業及台積電的業務需求下降，如果台積電不能透過降低成本或其他措施來有效抵銷需求下降的影響，營收、利潤與獲利率均會受到衝擊。

■ 技術變革

因應半導體產業與其技術的不斷變化，台積電的競爭利器為持續開發精密製程，以製造功能更多、更先進的產品。倘若台積電無法洞察技術提升的需要並迅速發展創新技術，或遇到競爭者無預期地取得更先進技術，台積電便可能無法以具競爭力的條件贏得先進積體電路製造服務的訂單。雖然台積電致力維持研發優勢，但若不能在技術或製程上繼續領先，或是未能取得由他人所發展的技術或製程之移轉或授權，台積電的競爭力將有所減弱。

6、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台積電堅實的核心價值、完善的公司治理、優異的營運績效，以及所秉持之「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」的社會願景，早已在國內外建立了良好的企業形象。自民國九十年起即連續十一年獲選道瓊永續發展指數的組成企業，並於民國九十九年獲得全球半導體領域第一名；多年來並獲得包括行政院國家永續發展獎—企業永續發展獎、經濟部卓越創新成就獎、行政院勞委會國家工安獎、環保署全國企業環保獎、天下雜

誌之全國最佳聲望標竿企業第一名、天下雜誌企業公民調查大型企業第一名、遠見雜誌企業社會責任獎、連續九年華爾街日報台灣十大最受尊崇企業第一名、快樂工作人雜誌新世代最嚮往企業第一名、以及投資人關係雜誌—台灣及香港地區最佳公司治理和台灣地區最佳投資人關係獎、經濟部國家產業創新獎之卓越創新企業獎等，就是最好的證明。

此外，公司設有品牌管理、客戶服務、公共關係、員工關係、投資人關係、風險管理、內部控制及文教基金會等各樣專責部門，統合全公司力量，力求在既有的良好企業形象基礎上再上層樓，同時做好各項因應準備，以杜絕、控制可能面臨的潛在危機。

7、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

自民國九十九年初至公開說明書刊印日為止，台積公司並未進行任何併購。

8、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

為滿足客戶需求，台積公司自民國九十三年起持續擴充在新竹科學園區及台南科學園區十二吋晶圓廠的產能，其每月總產能已從民國九十八年十二月三十一日的 17 萬 1,400 片增加至民國九十九年十二月三十一日的 24 萬 4,600 片十二吋晶圓。

總體來說，台積公司在民國九十九年度之產能較前一年度增加約 150 萬片八吋晶圓約當量，全年平均整體晶圓出貨產能利用率為 101%。產能的擴充及生產技術的提升會增加營運成本，例如：需要添購機器設備、人事的訓練或擴充。如果本公司無法相對增加營收來支付前述公司成本的增加，這將對本公司的財務造成負面的影響。

台積公司針對未來市場需求，建立一套預測和評量系統，來評估擴充或減少產能的效益，而截至公開說明書刊印日止，台積公司於民國九十九年度的產能擴充效益尚符合台積公司預期。

9、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

■ 採購集中的風險

➤ 原物料

台積公司需要適時取得生產晶圓所需的原物料，例如矽晶片、製程用氣體、化學原料、光阻等。由於台積公司採購的原物料中，有一些是由單一廠商所供應，在未及時找到替代供貨來源的狀況下，可能有供貨無法滿足需求的風險。台積公司有許多供應商來自日本，如日本地震即可能衝擊台積公司及時取得充足之原物料供應的能力。過去曾發生部分供應商或半導體業的原物料短缺，導致暫時性的價格調整和交期延誤。如果台積公司無法適時取得所需的原物料，或者原物料價格顯著上漲，而增加的成本無法轉嫁給客戶，則台積公司的營收和獲利將下降。為降低此風險，台積公司除致力於開發新供應商以降低單一供應商之風險與原物料價格外，亦與供應商密切合作推動分散供應商生產廠區與生產廠的在地化(臨近台積廠區)，並建立庫存計劃及每日庫存監控系統，以確保供應鏈維持合理之庫存水位與供應價格。

➤設備

台積公司的營運成長以及產能的持續擴充，也仰賴於我們是否能夠從有限的供應商中得到足量的設備及相關服務。在設備供應商的市場上經常是供給有限且交貨時間冗長。半導體相關產業中，機台的採購前置期可能長達九個月。為了減低這樣的風險，台積公司提供供應商機台需求預測來安排機台的生產計劃，並與廠商共同討論及訂定雙方認可的商業模式，以提前準備前置期較長的零組件來達到縮短購買機台的採購前置期。同時台積公司亦購置二手機台並持續尋找取得相關二手機台的機會。台積公司如果不能以合理的價格即時取得到所需要的設備，將可能無法滿足客戶的訂單，並在財務及營運上造成負面的影響。

■ 銷售集中之可能風險

雖然台積公司在全球各地擁有數百位客戶，來自前十大客戶的淨銷貨收入總和，在民國九十八年與九十九年，約佔公司當年淨銷貨收入的53%與54%，其中最大客戶則約佔10%與9%。若其中一位或多位主要客戶，因持續的競爭壓力、設計或委外製造的策略或做法改變、客戶或經銷商存貨調節時間的影響，而停止或顯著縮減採購規模，將可能對台積公司的營運與財務表現產生負面影響。

10、董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司影響、風險及因應措施：

台積公司現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。台積公司現有的股東可能會不定時地大量出售本公司之普通股或美國存託憑證（ADS）。例如：台積公司主要股東之一的行政院國家發展基金管理會，自民國八十六年起至民國九十四年間，即以美國存託憑證形式多次出售台積公司股份。

截至民國一百年九月三十日，行政院國家發展基金管理會仍持有本公司約6.4%的股權。

截至本公開說明書刊印日為止，台積公司並無持股超過10%之股東。

11、經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施

無。

12、其他重要風險及因應措施：

無。

(二) 訴訟或非訟事件

台積公司於九十五年八月，在美國加州阿拉米達高等法院對中芯國際集成電路製造有限公司、中芯國際集成電路製造（上海）有限公司以及中芯國際美國子公司（合稱「中芯公司」）提起訴訟，主張中芯公司違反雙方於九十四年所簽訂，針對中芯公司不當使用台積公司之營業秘密及專利侵權所達成之和解協議，並於不當使用營業秘密之部分請求禁制令與金錢賠償。中芯公司於九十五年九月對台積公司於同一法院提起反訴，主張違反和解協議及默示承諾之善意及公平原則。中芯公司並於九十五年十一月於北京市高級人民法院提起民事訴訟，

主張商業詆毀及違反誠信原則。九十八年六月十日，北京市高級人民法院做出對台積公司有利的判決並駁回中芯公司之訴訟。九十八年十一月四日，在歷經兩個月的審判後，美國加州阿拉米達高等法院的陪審團判決中芯公司違反與台積公司於九十四年簽訂之和解協議，且有不當使用台積公司營業秘密之情形。台積公司與中芯公司立即就上述之判決結果達成和解。根據新的和解協議，雙方均同意請求美國加州法院依據此一和解條件，對此項訴訟做出有利台積公司的合意判決；而中芯公司因北京市高級人民法院做出對台積公司有利判決所提出之上訴，也由中芯公司撤回。根據這份和解協議及合意判決，中芯公司同意除依先前九十四年和解協議下已支付台積公司的美金 135,000 仟元之外，再分期支付台積公司美金 200,000 仟元，以及在相關政府法規許可下，無償授予台積公司中芯國際集成電路製造有限公司 1,789,493,218 股普通股股份，及可於未來三年內以每股 1.30 港元認購中芯國際集成電路製造有限公司 695,914,030 股普通股股份之認股權證。台積公司業經經濟部投資審議委員會核准並已於九十九年七月五日取得上述普通股股份，並陸續依約取得上述現金賠償收入。

台積公司有時會接獲第三人的通知，主張台積公司所研發、或由台積公司所提供給同屬半導體產業之客戶使用的技術、設計或製程，有侵害他人專利或其他智財權之虞。某些情況下，這些爭議可能會導致雙方間的訴訟（台積公司或為原告或為被告），有時，支付和解金亦為雙方解決爭議的方式之一。無論這些第三人主張是否於法有據，或多或少已造成台積公司訴訟費用之負擔或可能對公司之營運造成不利之影響。

附屬於美國新墨西哥大學的技術移轉單位 STC.UNM，於九十九年六月向美國國際貿易委員會對台積公司及另一公司提出對一篇專利的專利權侵害訴訟。美國國際貿易委員會已於九十九年七月啟動調查程序。台積公司與美國新墨西哥大學的技術移轉單位隨後達成和解協議，且於九十九年十一月十五日就此和解協議提出終止調查之申請。負責本調查程序的行政法官已做出終止本調查案的初步裁決，美國國際貿易委員會已決定不再審閱行政法官的初步裁決，因此正式終止本調查。

Keranos 公司於九十九年六月，在美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。九十九年十一月，台積公司、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理，台積公司尚無法預知上述訟案之訴訟結果。

Ziptronix 公司於九十九年十二月，在美國北加州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及另一公司，提出對六篇美國專利之專利權侵害訴訟。本訴訟仍處於訴訟初期，本公司尚無法預知訴訟結果。

除前述訴訟案件之外，台積公司在最近兩年度及截至公開說明書刊印日止並無涉入其他重大訴訟案件。

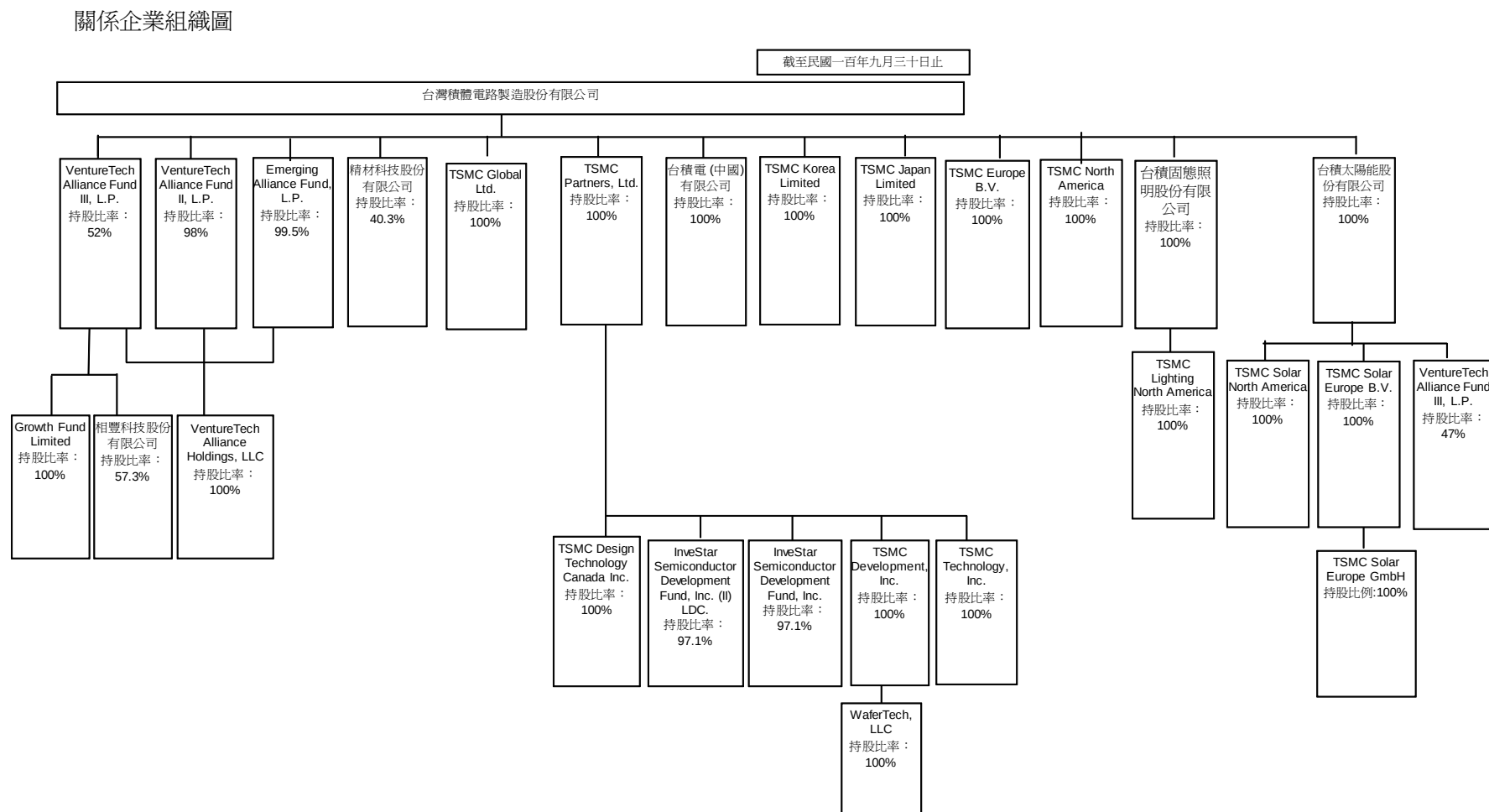
- (三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生財務週轉困難或喪失債信情事無。

(四) 其他重要事項

無。

三、公司組織

(一) 關係企業圖



與關係企業之關係及相互持股情形

截至民國一百年九月三十日止

單位：新台幣仟元

關係企業名稱	與本公司關係	本公司投資情形			投資本公司情形		
		持股比例	股數 (仟股)	原始投資金額	持股比例	股數 (仟股)	原始投資金額
TSMC Global	子公司	100.0	1	\$42,327,245	-	-	-
TSMC Partners	子公司	100.0	988,268	31,456,130	-	-	-
台積電中國子公司	子公司	100.0	-	14,356,567	-	-	-
TSMC North America	子公司	100.0	11,000	333,718	-	-	-
VTAF III	子公司	98.9	-	3,819,951	-	-	-
精材公司	具控制力之被投資公司	40.3	94,011	1,357,890	-	-	-
VTAF II	子公司	98.0	-	1,166,470	-	-	-
Emerging Alliance	子公司	99.5	-	971,785	-	-	-
TSMC Europe	子公司	100.0	-	15,749	-	-	-
TSMC Japan	子公司	100.0	6	83,760	-	-	-
TSMC Korea	子公司	100.0	80	13,656	-	-	-
台積太陽能公司	子公司	100.0	1,118,000	11,180,000	-	-	-
台積固態照明公司	子公司	100.0	227,000	2,270,000	-	-	-
TSMC Solar Europe	子公司	100.0	-	411,032	-	-	-
TSMC Solar NA	子公司	100.0	1	147,686	-	-	-
TSMC Lighting NA	子公司	100.0	1	3,133	-	-	-
TSMC Development	子公司	100.0	1	USD 0.001	-	-	-
ISDF	子公司	97.1	787	USD 787	-	-	-
ISDF II	子公司	97.1	14,153	USD 14,153	-	-	-
TSMC Technology	子公司	100.0	1	USD 0.001	-	-	-
TSMC Canada	子公司	100.0	2,300	USD 2,300	-	-	-

相豐科技公司	子公司	57.3	11,868	USD 3,937	-	-	-
Growth Fund	子公司	100.0	-	USD 1,780	-	-	-
VTA Holdings	子公司	100.0	-	-	-	-	-
TSMC Solar Europe GmbH	子公司	100.0	1	EUR 9,900	-	-	-
WaferTech	子公司	100.0	293,640	USD 280,000	-	-	-

(二) 董事會成員簡介

1、成員簡介

截至民國一百零九年九月三十日止

職稱 姓名	選(就) 任 日期(註 一)	任期至 (註一)	初次選任 日期(註 一)	選任時持有股份		現在持有股數(註 二)		配偶、未成年子女 現在持有股份(註 二)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股比率		
董事長 張忠謀	98/6/10	101/6/9	75/12/10	118,047,697	0.46%	123,137,914	0.48%	135,217	0.00%	美國麻省理工學院機械工程學士及碩士 美國史丹福大學電機工程博士 前美國德州儀器公司總公司集團副總裁 前美國通用儀器公司總裁暨營運長 前工業技術研究院董事長 美國麻省理工學院終身榮譽理事 美國國家工程學院院士	台積電公司總執行長
副董事長 曾繁城	98/6/10	101/6/9	86/5/13	36,144,509	0.14%	34,662,675	0.13%	132,855	0.00%	國立成功大學電機工程博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積電公司總經理 前台積電公司副總執行長	台積電(中國)有限公司董事長 創意電子(股)公司董事長 太極影音科技(股)公司董事 宏碁(股)公司獨立董事
董事 行政院國家發展基金 管理會 代表人：李鍾熙(註 三)	98/6/10	101/6/9	75/12/10	1,645,482,861	6.42%	1,653,709,980	6.38%	-	-	美國伊利諾理工學院化學工程博士 美國芝加哥大學企業管理碩士 美國哈佛大學進階企管班結業 前美國阿岡國家實驗室計劃主持人 前美國強生美西公司資深經理 前工業技術研究院院長 財團法人生物技術開發中心董事長 中華民國生物產業發展協會理事長	

董事 蔡力行	98/6/10	101/6/9	92/6/3	33,768,636	0.13%	34,091,046	0.13%	-	-	美國康乃爾大學材料工程博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積公司全球行銷暨業務執行副總經理 前台積公司營運長 前台積公司總經理暨總執行長 前台積公司新事業總經理	台積公司所屬子公司董事/執行長/ 總經理
獨立董事 彼得·邦菲	98/6/10	101/6/9	91/5/7	-	-	-	-	-	-	英國 Loughborough 大學工程榮譽學位 倫敦皇家工程學院會員 前 ICL Plc 董事長暨總執行長 前英國電信公司執行長及 Executive Committee 主席 英國品質基金會副總裁	荷蘭恩智浦半導體公司非執行董事 暨董事長 新力公司(日本)董事 L.M. Ericsson (瑞典)董事 Mentor Graphics Corporation Inc. (美國奧勒岡)董事 Actis Capital LLP (英國倫敦)非執 行董事 The Longreach Group 諮詢委員會委 員 新力公司諮詢委員會委員 New Venture Partners LLP 諮詢委 員會委員 Apax Partners LLP 顧問 Board Mentor, CMI Rothschild 資深顧問(英國倫敦)
獨立董事 施振榮	98/6/10	101/6/9	89/4/14	1,472,922	0.01%	1,480,286	0.01%	16,116	0.00%	國立交通大學電子工程學士及碩士 國立交通大學名譽工學博士 香港理工大學榮譽科技博士 英國威爾斯大學榮譽院士 美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士 宏碁集團創辦人、前董事長暨執行長	智融集團董事長 宏碁(股)公司董事 佳世達科技(股)公司董事 緯創資通(股)公司董事
獨立董事 湯馬斯·延吉布斯	98/6/10	101/6/9	98/6/10	-	-	-	-	-	-	美國普渡大學電機工程學士及碩士 美國普渡大學電機工程榮譽博士 國家工程學院 (NAE) 會員 前美國德州儀器公司執行副總經理暨半 導體集團總經理 前美國德州儀器公司總經理暨總執行長 前美國德州儀器公司董事長 前 Catalyst 董事長 Catalyst 榮譽董事 美國 Southwestern Medical 基金會理事 The Business Council 會員	美國 J. C. Penney 公司董事

獨立董事 鄒至莊	100/6/9	101/6/9	100/6/9	-	-	-	-	-	-	康乃爾大學經濟學學士 芝加哥大學經濟學碩士及博士 香港科技大學企業管理榮譽博士 台灣中央研究院院士 美國哲學學會院士 美國統計學協會院士 美國計量經濟學學會院士 曾於麻省理工學院史隆管理學院、康乃爾大學、IBM Thomas Watson 研究中心、哥倫比亞大學及普林斯頓大學等機構有超過五十年的研究教學經驗 曾為中華民國政府以及中國大陸就經濟政策、經濟轉型以及經濟教育上提供諮詢 中國大陸復旦大學、廣西大學、海南大學、南開大學、山東大學、人民大學、華科技大學、中國科學院研究生院管理學院、中山大學及香港城市大學榮譽教授 發表著作十四本及論文逾兩百篇 普林斯頓大學經濟學教授、1913 年級政治經濟學榮譽教授及 Lecture with the Rank of Professor	
獨立董事 陳國慈	100/6/9	101/6/9	100/6/9	112,000	0.00%	-	-	5,120	0.00%	英國 Inns of Court School of Law 英國大律師資格、新加坡律師資格以及美國加州律師資格 前美國紐約 Sullivan & Cromwell 法律事務所律師 前美國舊金山 Heller, Erhman, White & McAuliffe 法律事務所律師 前聯鼎法律事務所合夥人 前國振法律事務所合夥人 前漢聲出版社副總經理 前國家文化藝術基金會執行長 前台積公司資深副總經理暨法務長 前東吳大學教授 前國立政治大學教授 前國立清華大學客座教授 「台北故事館」及「撫臺街洋樓」創辦人暨總監 財團法人台積電文教基金會董事 中華民國行政院政務顧問及台北市政府市政顧問	

附註：

1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無

2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事：無

註一：民國年／月／日。

註二：截至民國一〇一年九月三十日實際持有股數。

註三：該法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東（股權比例佔前十名之股東名稱）
行政院國家發展基金管理會	不適用

該法人股東其主要股東為法人者：不適用。

2、董事所具專業資格及獨立性情形

依行政院金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

截至民國一百年九月三十日止

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註一）										兼任其他台灣 公開發行公司 獨立董事家數
		商務、財務、財 務、會計或公司 業務所需相關 科系之公私立 大專院校講師 以上	法官、檢察官、律 師、會計師或其他 與公司業務所需 之國家考試及格 領有證書之專門 職業及技術人員	商務、財務、 會計或公司業務 所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
董事長 張忠謀				√		√		√	√	√	√	√	√	√	0
副董事長 曾繁城				√	√			√	√	√	√	√	√	√	1
董事 李鍾熙	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
董事 蔡力行				√				√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 彼得·邦菲				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 施振榮				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 湯馬斯·延 吉布斯				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 鄒至莊	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0
獨立董事 陳國慈	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0

註一：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打「√」。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者，不在此限）。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

四、資本及股份

(一) 股本形成經過

1、 股本形成

單位：股／新台幣元

民國 年/月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財 產擴充股本者	核准日期與文號(註)
95/03	10	27,050,000,000	270,500,000,000	24,730,024,647	247,300,246,470	員工認股權行使：26,770,100元	無	95/03/21 園商字 第0950005792號
95/07	10	27,050,000,000	270,500,000,000	24,733,052,975	247,330,529,750	員工認股權行使：30,283,280元	無	95/07/19 園商字 第0950018699號
95/07	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,818,166,583	258,181,665,830	盈餘轉增資：7,141,632,380元 資本公積轉增資：3,709,503,700元	無	95/07/20 園商字 第0950018884號
95/09	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,823,356,941	258,233,569,410	員工認股權行使：51,903,580元	無	95/09/26 園商字 第0950025820號
95/12	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,825,839,775	258,258,397,750	員工認股權行使：24,828,340元	無	95/12/07 園商字 第0950031905號
96/03	10	27,050,000,000	270,500,000,000	25,829,687,846	258,296,878,460	員工認股權行使：38,480,710元	無	96/03/07 園商字 第0960005253號
96/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,832,959,219	258,329,592,190	員工認股權行使：32,713,730元	無	96/06/07 園商字 第0960014355號
96/07	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,419,387,460	264,193,874,600	盈餘轉增資：5,089,391,770元 資本公積轉增資：774,890,640元	無	96/07/06 園商字 第0960017514號
96/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,423,516,808	264,235,168,080	員工認股權行使：41,293,480元	無	96/09/12 園商字 第0960024269號
96/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,426,201,794	264,262,017,940	員工認股權行使：26,849,860元	無	96/12/26 園商字 第0960035468號
97/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,627,103,715	256,271,037,150	員工認股權行使：9,019,210元 買回股份註銷：8,000,000,000元	無	97/03/20 園商字 第0970006741號
97/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,629,241,609	256,292,416,090	員工認股權行使：21,378,940元	無	97/06/04 園商字 第0970014822號
97/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	26,151,365,437	261,513,654,370	盈餘轉增資：4,452,425,160元 資本公積轉增資：768,813,120元	無	97/08/06 園商字 第0970021495號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,936,820,778	259,368,207,780	員工認股權行使：21,293,410元 買回股份註銷：2,166,740,000元	無	97/09/10 園商字 第0970024882號
97/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,552,963	259,025,529,630	合併銷除股份：342,678,150元	無	97/09/23 園商字 第0970027199號
97/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,290,957	256,252,909,570	員工認股權行使：16,129,940元 買回股份註銷：2,788,750,000元	無	97/12/17 園商字 第0970035975號
98/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,625,437,256	256,254,372,560	員工認股權行使：1,462,990元	無	98/03/09 園商字 第0980005952號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,626,012,160	256,260,121,600	員工認股權行使：5,749,040元	無	98/08/17 園商字 第0980023001號
98/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,009,261	258,960,092,610	盈餘轉增資：1,931,207,890元 資本公積轉增資：768,763,120元	無	98/08/18 園商字 第0980023041號

單位：股／新台幣元

民國 年/月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財 產擴充股本者	核准日期與文號 (註)
98/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,896,353,344	258,963,533,440	員工認股權行使：3,440,830元	無	98/09/16 園商字 第0980026364號
98/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,900,662,339	259,006,623,390	員工認股權行使：43,089,950元	無	98/12/02 園商字 第0980034205號
99/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,902,706,622	259,027,066,220	員工認股權行使：20,442,830元	無	99/03/11 園商字 第0990005852號
99/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,903,769,184	259,037,691,840	員工認股權行使：10,625,620元	無	99/06/01 園商字 第0990015685號
99/09	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,905,017,151	259,050,171,510	員工認股權行使：12,479,670元	無	99/09/02 園商字 第0990025771號
99/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,907,343,943	259,073,439,430	員工認股權行使：23,267,920元	無	99/12/02 園商字 第0990035818號
100/03	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,910,078,664	259,100,786,640	員工認股權行使：27,347,210元	無	100/03/11 園商字 第1000007213號
100/06	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,193,297	259,141,932,970	員工認股權行使：41,146,330元	無	100/06/07 園商字 第1000015848號
100/08	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,283,114	259,142,831,140	員工認股權行使：898,170元	無	100/08/26 園商字 第1000025518號
100/12	10	28,050,000,000	280,500,000,000	25,914,149,208	259,141,492,080	員工認股權行使：8,660,600元 註銷庫藏股：9,999,660元	無	100/12/14 園商字 第1000037707號

註：民國年／月／日。

2、最近三年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股執行情形：

無。

(二) 主要股東名單

持股基準日：民國一百年七月五日

序號	戶號	主要股東名稱	持有股數	持有比率%
1	182689	花旗託管台積電存託憑證專戶	5,468,653,928	21.10%
2	1	行政院國家發展基金管理會	1,653,709,980	6.38%
3	1004757	摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	760,113,810	2.93%
4	149575	國泰人壽保險股份有限公司	376,533,235	1.45%
5	149617	大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶	364,978,136	1.41%
6	43068	花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	340,835,129	1.32%
7	1029741	富邦人壽保險股份有限公司	243,035,308	0.94%
8	181824	美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶	241,377,663	0.93%
9	1067968	德商德意志銀行台北分行受託保管蘇格蘭皇家銀行託管F S 太平洋領導基金投資專戶	226,909,807	0.88%
10	900349	寶來台灣卓越50基金專戶	222,860,366	0.86%

(三) 最近兩年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形

不適用。

(四) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

項目	民國 98 年	民國 99 年	民國 100 年 1 月 1 日 至 100 年 9 月 30 日
每股市價			
最高	59.00(註一)	69.90(註一)	75.00(註一)
最低	30.42(註一)	51.20(註一)	63.30(註一)
平均	47.80(註一)	57.54(註一)	69.76(註一)
每股淨值			
分配前	19.11	22.16	23.10
分配後	16.11	19.16	-
每股盈餘			
加權平均股數 (仟股)	25,912,457	25,919,814	25,923,933
稀釋每股盈餘	3.44	6.23	3.96
調整後稀釋每股盈餘 (註一)	3.44	6.23	-
每股股利			
現金股利	3.00	3.00	-
累積未付股利	-	-	-
投資報酬分析			
本益比 (註二)	13.90	9.24	-
本利比 (註三)	15.93	19.18	-
現金股利殖利率 (註四)	6%	5%	-

註一：業已追溯調整盈餘分配之影響數。

註二：本益比=當年度每股平均收盤價 / 調整後之稀釋每股盈餘。

註三：本利比=當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利。

註四：現金股利殖利率=每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1、公司章程所載員工分紅及董事酬勞之有關資訊

依本公司章程規定，公司分派每一營業年度盈餘時，應於依法提撥公積後，提撥所餘盈餘不高於 0.3% 作為董事酬勞，及不低於 1% 作為員工紅利。

2、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：實際配發情形與估列數無差異。

3、盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：不適用。

4、盈餘分配議案業經股東會決議者：

本公司於九十九年度所認列之員工獎金與紅利及董事酬勞如下：

—員工現金獎金新台幣10,908,338,094元

—民國一百年股東常會通過配發員工現金紅利新台幣10,908,338,094元

—民國一百年股東常會通過發放董事酬勞新台幣51,131,000元

- 5、前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

民國九十九年度董事酬勞及員工紅利如下，其實際配發金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

	董事會決議	實際發放數
	金額	金額
	(新台幣元)	(新台幣元)
董事酬勞（現金）	51,131,000	51,131,000
員工現金紅利	10,908,338,094	10,908,338,094
合計	10,959,469,094	10,959,469,094

貳、營運概況

一、公司經營

（一）業務內容

1、業務範圍

身為專業積體電路製造服務的創始者和領導者，台積公司的成就源自於提供客戶先進的製程技術、「超越摩爾定律」（More-than-Moore）的製程技術，以及優異的生產效率。台積公司致力於提供客戶最高的整體價值，視客戶的成功為台積公司的成功。

台積公司提供了全面整合的積體電路製造服務，滿足客戶日益多樣化的需求，也因為與客戶建立的夥伴關係而獲致極大的成長。台積公司藉由優異的最先進製程技術、領先的設計服務、量產能力和產品品質，滿足客戶生產需求，並贏得來自全球客戶的信任。

民國九十八年五月，台積公司設立新事業組織，以開拓專業積體電路製造服務領域以外的相關市場機會。為激勵創業精神及落實專業分工，以強化公司整體競爭力及營運效率，台積公司股東會於民國一百年六月決議，核准將太陽能業務及固態照明業務分別分割讓與兩家新設且由本公司百分之百持有之台積太陽能股份有限公司及台積固態照明股份有限公司，並以民國一百年八月一日為分割基準日。

過去二十三年來，全球已有超過600家客戶透過台積公司生產應用於個人電腦與其週邊產品、資訊應用產品、有線與無線通訊系統產品、汽車與工業用設備，以及包括數位影音光碟機、數位電視、遊戲機、數位相機等消費性電子與其他應用產品的晶片。

未來終端電子產品的日新月異，將促使客戶更加廣泛地採用台積公司創新的技術與服務，同時也更促進台積公司自身的技術發展，台積公司深信成功將屬於產業的領導者而非追隨者。

■ 最近二年度銷售量值表

單位：銷售量 (八吋晶圓約當片數) / 銷售值 (新台幣仟元)

		民國 99 年		民國 98 年	
		銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓	內銷	2,132,697	51,312,831	1,495,305	38,538,370
	外銷	9,688,352	340,474,577	6,194,167	238,090,692
包裝元件	內銷	0	0	3	487
	外銷	23,550	963,427	35,467	1,384,580
其他	內銷	20,278	3,974,831	17,597	3,272,217
	外銷	53,137	21,940,782	42,979	18,184,868
合計	內銷	2,152,975	55,287,662	1,512,905	41,811,074
	外銷	9,765,039	363,378,786	6,272,613	257,660,140

2、產業概況

■ 產業未來展望、機會與挑戰

➢ 專業積體電路製造服務市場的需求與供給

相較充滿挑戰的民國九十八年，積體電路製造服務領域的銷售在民國九十九年展現了 43% 的大幅成長，主要推力來自於終端市場需求復甦與供應鏈的存貨回補。

民國一百年專業積體電路製造服務領域預計將成長 4%。展望未來，隨著全球經濟穩定發展、電子產品採用半導體元件的比率提升，及整合元件製造商擴大委外代工，從民國九十九年至民國一百零四年，專業積體電路製造服務領域的年複合成長率可望較整體半導體產業年複合成長率為高。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品息息相關。

✓ 通訊

民國九十九年通訊產業恢復成長，其中手機的單位出貨量增加 14%。中國大陸和印度等新興市場國家的手機用戶持續成長，同時已開發國家的手機銷售也恢復穩定。高階的智慧型手機在手機市場上也有非常亮眼的表現。民國一百年，第三代行動電話（3G）的日漸普及和第四代行動電話（4G/LTE）的推出將為市場注入一劑強心針。智慧型手機在高效能、低耗電及其他更智慧型應用上的提升，均是持續推動手機購買力的誘因。

在 IC 設計上，低耗電的特性對手機而言已是不可或缺。系統單晶片的設計與高速運算性能有利於複雜的軟體運作，也將加速晶片製造轉進先進製程的時程而加惠於台積公司，因台積公司在先進製程方面已是市場上的領導者。

✓ 電腦

相較於民國九十八年的個位數成長，電腦產業在民國九十九年大幅

成長了14%，其中，企業用電腦展現了較強的成長力道，家用電腦則因對經濟前景的不確定與平板電腦部分取代低階小筆電而需求減緩。其中，中國和其他新興國家的成長力道強勁，而已開發國家則相對疲軟。

展望民國一百年，電腦產業可望持續成長，預計企業用電腦的汰舊換新，將會帶動整體產業的成長；而家用電腦的成長則因選擇性高的多樣化產品如多媒體平板電腦、下一代智慧型手機等而受到影響。新興國家依舊會是成長的動力。虛擬化及綠色電腦等新的應用亦有助刺激電腦的消費。

就 IC 產品設計來看，隨著電腦使用的半導體元件如中央處理器、繪圖處理器與晶片組等，對低耗電、高性能及整合能力的要求提升，40 奈米和 28 奈米先進製程的需求亦可望增加。

✓ 消費性電子

經歷了連續兩年的停滯，民國九十九年消費性電子業重獲成長動能，整體單位出貨量增加了8%，各國政府（如中國和日本）的補助方案、新興國家的 CRT 電視換機潮和數位相機（DSC）的銷售復甦均成為驅動市場消費的動力；此外，如數位電視（DTV）、藍光 DVD 播放器與數位相機等各式消費性電子產品平均售價持續下跌，亦有助於市場買氣回升。

展望民國一百年，新穎功能的電子產品將會刺激市場的銷售量，高畫質影像、網路連結和 3D 的潮流，勢必將催化數位電視、數位機上盒與藍光 DVD 播放器的銷售。

此外，數位消費電子產品的創新應用已創造了如電視遊樂器的運動感測器、3D 顯示手持遊戲機等新產品使用模式，除將提高對先進製程技術的需求外，也將進一步增加對如互補金屬氧化物影像感測器、高壓製程、微機電製程等「超越摩爾定律」（More-than-Moore）特殊製程的仰賴。台積公司提供的技術全面且完整，以求在新趨勢下持續獲利。

✓ 新興應用不斷崛起

新興應用如多媒體平板電腦對積體電路製造服務業的貢獻正在逐漸發酵。在蘋果電腦 iPad 的帶領下，多媒體平板電腦於民國九十九年已出貨 1,700 萬台，強勁的銷售動能將隨著傳統電腦設備商與手機廠商推出更多機型而持續至民國一百年。預期民國一百零四年間，多媒體平板電腦市場將以 43% 的年平均複合成長率，驅動積體電路製造服務業的強勁成長。

■ 產業供應鏈

電子產品的供應鏈不僅複雜冗長，且各個環節環環相扣。作為產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供及時且充足的產能以因應市場的激烈變化，而專業積體電路製造服務更是確保產業鏈穩定的重要元素。台積公司身為專業積體電路製造服務領域的領導者，將持續提供最先進的製程技術及充足的產能，以確保整體產業的穩定與持續創新。

3、技術及研發概況

■ 研發團隊之組織與投資

民國九十九年，台積公司持續增加研發投資，進一步強化三大核心競爭優勢中的技術領先優勢，全年研發預算約佔總營收之 7%，此一研發投資規模不僅與眾多世界級一流半導體科技公司相當，甚至超越了許多公司的規模。由於研發預算增加，台積公司也同時擴增研發團隊人力，增幅超過 17%。

有鑑於驅動互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 製程微縮的摩爾定律是否能繼續延伸，已面臨眾多技術面之困難，台積公司持續努力提升其研發組織的能力，加上在擁有豐富半導體研發經驗的研發資深副總經理蔣尚義博士的領導之下，相信將能克服眾多技術上的挑戰。

民國九十九年，台積公司率專業積體電路製造服務領域之先，提供第一個 28 奈米製程技術。透過迅速密集的努力，此一先進製程技術已達到穩定的良率，提供客戶更佳的競爭優勢。同時，台積公司也加速了先進元件、嵌入式記憶體與超低介電層銅導線技術的發展。此外，台積公司於民國九十九年也領先專業積體電路製造服務領域，提供 28 奈米高介電層／金屬閘 (HKMG) 製程服務，並成功開拓了 20 奈米先進製程技術創新領域，再次證明了台積公司研發團隊堅實的能力。

台積公司亦致力於擴展與研發夥伴的合作以及與世界級研發機構的聯盟，例如：台積公司是位於歐洲的知名半導體技術研發中心 IMEC 的核心會員，同時也與矽智財公司策略合作，促成先進製程之矽智財研究發展。此外，台積公司也加強與主要合作夥伴對設計和製程做最佳化的研究開發，並持續贊助國內外主要的大學從事奈米科技研究，以推動創新及先進技術。

上述研發上的努力與投入，讓台積公司屢屢能夠領先專業積體電路製造服務領域，提供客戶量產製程技術和設計解決方案，以協助客戶在複雜且充滿挑戰的市場環境成功推出其產品。



*合併基礎下的研發支出。

■ 民國九十九年研究發展成果

➤ 研究發展組織卓越成果

✓ 28 奈米製程技術

台積公司持續領先專業積體電路製造服務領域，發展包括傳統以及高介電層／金屬閘(HKMG)等最先進的邏輯製程技術。高效能(28HP)平台係針對高速繪圖處理器以及中央處理器的應用而開發，而藉由額外的元件客製化漏電管理，此 28HP 平台亦可作為高階可程式化閘陣列及系統單晶片等應用的技術骨幹。此外，低耗電技術(28LP 及 28HPL)則支援低成本行動通訊應用及低階可程式化閘陣列的需求。

台積公司保有持續不斷的改善及開發動能，一次又一次地在 28LP、28HP、28HPL 技術上刷新 64Mb 靜態隨機存取記憶體良率紀錄，並且順利達成 64Mb 靜態隨機存取記憶體良率及可靠度目標。此外，28 奈米低耗電技術(28LP)率先在民國九十九年九月完成製程驗證，讓台積公司成為半導體及專業積體電路製造服務產業第一家能夠提供 28 奈米技術試產的公司。而 28 奈米高介電層／金屬閘製程驗證，也按照計劃順利進行中。

同一時間，台積公司也提供 28 奈米晶圓共乘專案，並成功地協助傳統的氮氧化矽／多晶矽閘以及高介電層／金屬閘兩種不同技術的客戶群進行設計測試晶片的設計評估及驗證。於民國九十九年，一共推出超過十個 28 奈米晶圓共乘專案，協助超過二十五家客戶完成測試晶片驗證。產出測試晶片含括高速繪圖處理器以及中央處理器、可程式化閘陣列及行動通訊不同市場應用。

✓ 20 奈米製程技術

民國九十九年，台積公司持續專注於研發 20 奈米的先進製程。為了提供領先的類比以及數位應用產品的晶片製造技術，台積公司採用最先進的 193 奈米浸潤式曝光顯影 (Immersion) 機台以及強化的微影

(Lithography) 技術，以因應更小尺寸的晶片製造。由於結合了第二世代的高介電層與金屬閘極元件結構 (HKMG)、更多的矽應力，以及新的元件結構等新製程優勢，純電晶體之執行效能仍然依循摩爾定律而進一步提高。此外，藉由採用一種特別設計的技術，能夠有效地減少與控制外在電阻(External Resistance)。另外，後段製程(Back-end of Line, BEOL)擁有以超低介電層作為金屬間介質材料以及採用創新的低電阻－電容 (RC) 延遲結構的銅金屬化製程等優勢。台積公司 20 奈米邏輯電晶體與靜態隨機存取記憶體的單位元 (Bit Cell) 能夠涵蓋包括高效能與系統單晶片相關產品之應用。

20 奈米技術的發展需要極高的閘級密度與晶片操作效能，而長久以來，先進製程之昂貴成本與複雜度，每每困擾設計客戶。有鑑於此，民國九十九年，台積公司針對 20 奈米先進製程，提供給客戶製程、設計工具與矽智財，以協助客戶降低代工製造成本。台積公司的高性能 20 奈米先進製程預計於民國一百零一年第三季進行試產，並於民國一百零二年第一季進入量產階段。

✓ 微影技術

為了達到兩倍於上一代的閘極密度，目前最先進的光學微影曝光技術，

例如：整合式顯影光源最佳化與多重成像，已達到 20 奈米成像解析度的極限。使用最新開發的微影成像技術，此一解析度的極限可被克服。好的開極線寬控制可以獲得較佳效能的電晶體，結合一個最佳化的蝕刻技術，薄膜條件與非線性光感應材料，今年已達成 2.2 奈米的開極線寬變異（LWR）的目標。

民國九十九年，20 奈米 TV1 光罩已開始試產與測試。利用最先進的超級二元式光罩技術（Super-BIM），可達到 6 奈米疊對誤差的控制，較前一技術世代有 25% 的改進。同時，使用一個最佳化的設計規範（Design-rule），在擴散層的成像技術可從三次微影成像簡化為兩次微影成像，並進一步達到低成本的目標。

而藉由光阻掃描機和材料的最佳化整合，採用台積公司浸潤式微影技術的 28 奈米晶片，其缺陷密度幾乎接近於零。奠基於前一代技術的優勢，此一世代技術又較前一代更為精進。

台積公司亦使用客製化的光學近接校正來支援不同產品的需要。此外，針對 0.11 微米邏輯產品和其他多種不同世代的邏輯產品如嵌入式動態隨機存取記憶體和互補金屬氧化物半導體影像感測處理器，台積公司也已發展出低成本的解決方案。在次世代微影技術的發展方面，台積公司已經於其晶圓廠內安裝多重電子束無光罩 Multiple E-beam Maskless 的測試原型機台；並完成以 110 道電子束，施以鄰近修正直寫出 20 奈米世代圖形的驗證。

民國九十九年初，台積公司宣佈將從荷蘭艾司摩爾股份有限公司取得一台極紫外微影掃描機，用於十二吋超大晶圓廠 20 奈米世代及以下世代製程技術的開發。台積公司也用 IMEC 的極紫外微影研發機台於 20 奈米的製程技術，並取得了一定的進展。

✓ 光罩技術

光罩技術是先進曝光顯影技術中極為重要的一環。台積公司自身擁有先進的光罩製造技術，並利用此一優勢，開發出最佳化的增強曝光顯影解析度的技術。藉由整合光學近接校正、掃描式曝光機參數優化與光罩，台積公司提供 193 奈米浸潤技術的完整解決方案。台積公司擁有完備的光罩技術設備，包括最先進的電子束光罩寫入器、蝕刻機、檢測、修復、驗證及量測機台，充分支援 28 奈米製程技術的量產以及 20 奈米製程技術的研發。台積公司繼續研發 193 奈米浸潤式微影雙重曝光所需的光罩技術及針對 20 奈米製程技術以及更先進製程技術所需的極紫外光微影光罩技術，並積極地參與極紫外微影光罩製作所需建構的開發。台積公司的光罩技術擁有優異的技術能力，提供客戶最高品質的光罩、快速的交貨期，以及一站式的服務，為客戶帶來重要且獨特的價值。

➤ 導線與封裝技術整合

導線與封裝技術整合部門（Integrated Interconnect and Package Development Division, IIPD）於民國九十七年底成立，負責開發與提供結合先進導線和封裝技術的整合技術解決方案，同時也肩負許多具有挑戰性的任務，包括將超低介電層（Extreme Low-K Dielectric, ELK）導入

45/40 奈米製程技術。民國九十九年的研發重點在於突破導線與封裝相關技術瓶頸，並確保第一批採用 45/40 奈米製程技術的客戶產品能夠順利量產。此外，透過強化矽後段導線製程／晶圓凸塊結構設計，以及晶圓凸塊／封裝製程最佳化，得以提供品質可靠的產品。目前客戶的 45/40 奈米繪圖核心晶片（GPU）和可編程邏輯閘陣列（FPGA）產品已成功進入量產（晶粒尺寸大於 20x20 平方毫米）。

✓ 先進導線技術

民國九十九年，台積公司持續領先專業積體電路製造服務領域，開發出 RC 延遲最低且與先進封裝技術相容的導線技術。

由於製程技術持續推進所引發的尺寸效應，銅導線電阻率也隨之增加。有鑑於此，台積公司針對 28 奈米及更先進製程技術開發出超低電阻銅導線的解決方案，以確保先進導線的 RC 延遲目標。台積公司 28 奈米進一步改善銅導線，使其有效電阻率顯著低於國際半導體技術藍圖（The International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS）的預估值，同時，亦呈現相當不錯的可靠性測試結果。

✓ 先進封裝研究發展

為達到「綠色封裝」的要求以及遵循歐盟 RoHS 法規，傳統的錫—鉛（Sn-Pb）焊材導線將被無鉛（Sn-Ag or Cu Post）技術逐步取代。

本公司於民國一百年繼續開發無鉛封裝技術，涵蓋晶粒尺寸、晶圓凸塊間距、基材形式等方面，與應用於手持／可攜式裝置之扇入型晶圓級封裝（Fan-in Wafer Level Package），以進一步提升客戶產品效能。

✓ 三維積體電路（3D IC）

藉由自身研發之矽穿孔通道（TSV）及與積體電路製造服務業者相容的晶圓級封裝技術，台積公司承諾與客戶緊密合作開發符合成本效益的三維積體電路系統整合方案。台積公司的三維系統級封裝技術（System-in-Package, SiP）解決方案得以協助許多客戶的終端產品達到成本最佳化與產品週期最佳化，本公司首創提供多項創新技術以利三維晶圓級封裝（SiP）設計的進行，包含三維晶圓級封裝設計、封裝電性分析及參數粹取、時序、訊號完整性、阻抗壓降，以及散熱與物性設計準則查驗和布線與布局比對。此整合解決方案預計將於民國一百零一年至一百零二年提供給客戶。

➤ 先進電晶體元件研究發展

過去電晶體元件的效能需求依照產品市場而不同，分為高效能應用產品如桌上電腦等，低耗電應用產品如筆記型電腦或可攜式網路裝置等，以及低待機耗電應用產品如需長時間待機的手機等。台積公司藉由泛用家族（G-family）電晶體元件，在低耗電應用產品領域向來位居技術領先地位，並以低耗電家族（LP-family）電晶體元件馳騁低待機耗電應用產品領域。當低耗電應用產品擴及高效能需求的範疇，台積公司迎接挑戰，調整精進電晶體元件，以確保客戶獲得最具競爭力之電晶體元件。

➤ 多樣且完備的製程技術

除了上述先進製程的研發成果，台積公司亦持續成功開發出多樣化的新製程技術，並加速了系統單晶片的技術藍圖，包括提早嵌入式動態隨機存取記憶體（Embedded DRAM）與射頻製程的推出時程，並提供更高的整合度及更多的不同選擇。

✓ 嵌入式動態隨機存取記憶體

民國九十九年，台積公司在嵌入式動態隨機存取記憶體技術持續領先，導入 40 奈米低耗電（N40LP）嵌入式動態隨機存取記憶體製程的先期量產，為用於遊戲與數位電視等頻寬與繪圖處理應用的產品等，提供更有效的記憶體密度與產能。隨後，將持續進行用於基頻與網路產品的 40 奈米泛用型（N40G）基礎邏輯製程，此製程擁有時脈速度（Clock Rate）達到 412 百萬赫茲（MHz）與 500 百萬赫茲（MHz）的優勢。28 奈米嵌入式動態隨機存取記憶體的技術已進行開發，其使用高介電金屬閘極邏輯製程為基礎技術。

✓ 矽鍺雙載子互補金屬氧化物半導體射頻技術（Silicon Germanium BiCMOS RF Technology）

台積公司 0.18 微米矽鍺雙載子互補金屬氧化物半導體技術效能已進一步提升，符合世界一流之矽鍺製程規格，並已超越國際半導體技術藍圖（ITRS）所訂下的目標。

✓ 混合訊號／射頻技術

在 28 奈米先進製程部分，台積公司成功開發出建構在電磁模擬理論之 LC-Tank 設計套件，以符合高速串化器（Serdes）設計應用，並在此基礎上針對不同客戶之金屬層結構（Metal Schemes），協助客戶成功大幅縮短設計流程。在「超越摩爾定律」的特殊製程應用方面，我們在高阻值基板上開發 IPD 元件技術，對於 RF-FEM 的設計應用，也已成功開發出高效能電感（ $Q > 50$ ）以及高精準 MIM 電容元件（C corner < 5%）。

薄膜電阻：台積公司成功開發出溫度系數趨近於零的薄膜電阻，其為高精度度類比數位轉換電路的關鍵元件。

✓ 電源 IC／雙極—互補金屬氧化半導體—雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）技術

民國九十九年，台積公司在現有的 0.25 微米 BCD 電源管理製程中推出了多次可程式非揮發性記憶體（MTP NVM）的技術，而一次可寫入式（OTP）e-fuse 解決方案也在 0.25 微米 5V 與 0.18 微米 5V 混合信號製程及相關的 BCD 和高壓製程中都通過可靠性驗證。這些解決方案不但讓客戶以更有效率的成本在晶片、封裝和電路板上都可以調整其類比特性，同時也增加了產品的多次可程式功能（Multiple Time Programming, MTP）。

除了繼續研發更多針對 DC-DC 轉換應用的 BCD 製程以外，台積公司還成功推出了超高壓（800V）製程，讓客戶可以使用在與節能照明（CFL, LED, E-balaster）和手機充電器有關的應用上。

✓ 面板驅動技術

民國九十九年，台積公司開發完成二項可攜式顯示元件驅動 IC 新技術—C011HV 及 N80HV，並將應用於高解析度之智慧型手機。為了符合更高規格的新電視，如 3D 液晶電視的大尺寸顯示器應用（色階及速度），台積公司在民國九十九年完成以上兩項技術的開發。

✓ 微機電系統技術

台積公司目前正在進行開發數種不同的微機電應用發展技術。民國九十九年，我們與客戶合作並發表了一個陀螺儀裝置並已經量產，同時初步證明了 DNA 測序裝置，在運動傳感器的技術平台發展上也已取得重大進展。

✓ 互補金屬氧化物半導體影像感測處理器技術

民國九十九年，台積公司持續保有背面感光（Backside Illumination, BSI）影像製程技術領導地位，並協助客戶贏得手持產品市場的顯著優勢。此外，台積公司的十二吋標準矽製程（Bulk Silicon）背面感光影像製程技術，已鎖定 65 奈米畫素密度高達 800 萬畫素產品，開始進行試產，並在民國一百零一年逐步提升產量，屆時將有更多多元化的產品加入量產行列。

同時，台積公司也取得另一家互補金屬氧化物半導體影像感測處理器產品供應商訂單，將合作進行十二吋技術發展，預計民國一百零一年出貨。

✓ 快閃記憶體／嵌入式快閃記憶體技術

民國九十九年，台積公司推出針對微控制器（MCU）應用產品所精調的低電壓及超低漏電流之 0.18 微米快閃記憶體技術。同時，90 奈米分離閘（Split Gate）技術不僅擁有優異的良率、通過技術驗證（Qualification），並有三項巨集（Macros）取得產品驗證。此外，已有一家主要客戶產出藍芽工程樣品，另有多家客戶利用晶圓共乘服務專案，產出智慧卡矽智財之產品原型，並取得驗證。台積公司已贏得多家整合元件製造公司的青睞，針對汽車電子、工業以及消費性電子產品，共同合作開發其快閃記憶體單元涵蓋懸浮閘（Floating Gate）、分離閘（Split Gate）以及混成式（Hybrid）的 90 奈米、65 奈米以及 55 奈米技術嵌入式快閃記憶體解決方案。

■ 技術平台

現今積體電路設計者需要一套精緻的設計基礎架構，來達成令人滿意的生產力及工期。這其中包括了電子設計自動化（EDA）流程、通過矽晶片驗證的資料庫和矽智財、模擬及驗證用的設計套件，如製程設計套件（PDK）及技術檔案。這些都以製程技術為建構的基礎，而每一項製程技術都需要有各自的設計基礎架構，讓設計者容易使用，這就是技術平台的概念。

多年來台積公司與其策略夥伴投入相當多的努力來建構技術平台。民國九十七年，台積公司推出「開放創新平台計劃」，以進一步強化台積公司既有的技術平台，並在民國九十九年獲得多項成果。該年十月，台積公司將 Soft-IP 元件供應商納為矽智財聯盟延伸計劃的一環。

此外，民國九十九年四月，台積公司發表專業積體電路製造服務領域的第一個類比／混合訊號（AMS）參考設計流程，以及第二次更新版本的射頻設計參考流程（RF RDK）。這個新的 AMS 參考設計流程是台積公司第一個客製化的設計流程，針對先進 28 奈米製程諸多的設計挑戰如共通布局相關效應（LDE）、可製造性設計（DFM）、與低於 1V（Sub-1V）的設計考量，提供降低設計阻礙及減少重複設計的解決方案。AMS 參考設計流程是結合眾多廠商之力所提出的創新完整套件。

更新的射頻設計參考流程為電路設計業者的共同問題提供了解決方案，其 2.0 版本包含了按部就班的自習教學和基本設定程式，以便利使用者在設計電路元件尺寸上的考量，配合台積公司製程設計套件使用的電磁效應設計流程，並藉由台積公司驗證通過的基層雜訊分析工具，以分析射頻電路中的基層雜訊干擾效應。

民國九十八年，台積公司首次發表可交互操作的多項電子設計自動化技術檔案格式，包含共通寄生元件參數萃取程式（iRCX）、共通設計法則檢查（iDRC）、共通布局與電路比較（iLVS）、共通製程設計套件（iPDK），並在民國九十九年推出業界第一套的 40 奈米 iDRC 與 iLVS，以及涵蓋 0.13 微米至 28 奈米的 iPDK 技術檔案，以實現台積公司不斷為客戶提供更好設計生態環境的承諾。台積公司與電子設計自動化工具供應商合作，每季發佈最新驗證後的工具名稱及版本。新的矽智財聯盟計畫希望能加速 Soft IP 業者在先進製程準備就緒並提早上市時程。多年以來，Soft IP 的發展獨立於製程技術之外，在晶片的用電、效能與面積等方面並未達到最佳化。基於系統單晶片（SoC）等高整合性的晶片設計，對於「首次生產即成功」與「提早產品上市時程」的需求與日俱增，專業積體電路製造與矽智財業者之間的緊密技術合作將更形重要，才能讓晶片設計達到最佳表現。

iRCX 是台積公司和電子設計自動化工具供應商共同制定的數據格式，當使用先進製程技術的晶片設計需要詳細描述電阻電容雜散效應，以精準評估晶片效能及功耗時，電路連接線的電阻電容模型數據就益顯重要。iRCX 是以積體電路製造廠商的模擬數據為基礎，提供給不同的應用工具使用。

除了基本的寄生元件萃取工具外，同時也包括了常用的電磁波設計工具（Electrical Magnetic, EM）、電磁場效應分析（Field Solver）、電性遷移工具（ElectroMigration）、及電壓衰減工具（IR Drop Analysis），凡是支援 iRCX 的電子自動設計化工具，都能從台積公司開發的 iRCX 檔案讀取精準的電路連接線模型數據。

民國九十九年，台積公司陸續發表用於 40 奈米製程技術的電子自動設計化共通數據格式—iDRC、共通金屬層密度填補程式（iFill）及 iLVS，並已提供客戶使用。先進製程技術的設計法則非常複雜，且為了正確的晶片布局及後布局分析，電子設計自動化工具需要詳細而精準的設計法則描述。台積公司的 iDRC 及 iLVS 根據其製程技術的需求，統一製程技術設計法則的規格及技術檔案的製作、簡化了數據的傳遞、確保了數據的完整性，及在各電子設計自動化公司工具上使用的共通性。以上的種種成績具體呈現了台積公司、電子設計自動化工具供應商以及雙方共同客戶，彼此緊密合作的優異成果。

台積公司的 iPDK 統一了業界標準 OpenAccess 數據庫上的數據模型，因而促成設計再使用，這在多個私有製程設計套件（PDK）及設計數據庫共存時是

絕無可能實現的。它不僅免除了重複開發製程設計套件的虛功，顯著降低整個設計生態系統製程設計套件開發、驗證及支援的成本，並提升在類比及全手工電路設計上的創新機會。根據台積公司不同製程上所提供的 iPDK 與電子設計自動化設計平台，使用者可以更有彈性地選擇最適用的設計工具。

為了確保開放創新平台合作夥伴符合台積公司新製程的要求，台積公司和相關的合作夥伴在 TSMC-Online 上發佈「電子設計自動化工具驗證報告」(EDA Tool Qualification Report)，以提供客戶主動性的維護，包含設計法則檢查 (DRC)、布局與電路比較 (LVS)、寄生元件參數萃取 (RCX) 及布局與繞線工具 (Placement and Routing)。DRC、LVS 與 RCX 的實體驗證工具報告每季更新一次，從民國九十九年開始，開始涵蓋 iDRC、iLVS、iRCX 與 iFill。另外，在 28 奈米設計法則成為 1.0 版本後，繞線工具驗證也在民國九十九年問世。

為了降低客戶採用先進製程的障礙，台積公司在民國九十八年率先提供 65/55 奈米的整合設計流程 (Integrated Sign-Off Flow, ISF)。ISF 是一個奠基於台積公司多年設計經驗所誕生的產品驗證設計流程。台積公司在 ISF 所投入的努力，在民國九十九年開花結果，並帶來多數初次使用 65/55 奈米製程的客戶群，並大幅降低中國大陸等新興的市場採用先進製程技術的門檻。台積公司的參考設計流程 (TSMC Reference Flow) 已堂堂邁入第十年，一向針對客戶需求，不斷推出先進設計方法，並事先驗證電子設計自動化工具的實際效用。一般的參考設計流程大多是針對功耗、時序、可製造性設計提出解決方案，而參考設計流程 11.0 則更進一步整合先進製程技術如 28 奈米製程所面臨的新挑戰，擴展出兩個全新領域—矽穿孔式的 3D 積體電路 (3DIC-TSV) 和電子系統階層 (ESL) 設計。前者提供了多數不同屬性晶片的整合以達到卓越的時序／功耗最佳化；後者則是為了支援客戶設計朝向系統階層化的趨勢，協助客戶的晶片設計能更早並更精確地估計晶片用電、效能與面積，以期達到最佳表現。

(二) 市場及產銷概況

1、市場分析

民國九十九年，即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之積體電路製造服務領域，仍以45.5%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。民國九十九年，約有46%的營收來自65奈米及其他更先進的製程；同年十一月，更成功締造了45/40奈米十二吋晶圓出貨第五十萬片的新里程碑。另外，台積公司也領先專業積體電路製造服務領域，推出28奈米製程。

台積公司以成為客戶最佳合作夥伴為目標，除了提供先進的製程技術，同時也提供創新的服務。台積公司在民國九十九年發表領先專業積體電路製造服務領域的類比／混合訊號參考設計流程，並推動Soft IP矽智財聯盟 (Soft IP Alliance)，讓Soft IP業者將耗電、效能與面積等方面的考量在台積公司的技術基礎上予以最佳化。同時，透過第二版射頻參考設計套件的發佈，進一步強化開放創新平台 (Open Innovation Platform™)，為半導體設計業帶來最具時效的創新。台積公司在民國九十八年首次發表可交互操作的多項電子設計自動化技術檔案格式 (iRCX、iDRC、iLVS、iPDK)，並在民國九十九年提供業界第一套從0.13微米到28奈米的iDRC/iLVS/iPDK技術檔案，實現台積公司不斷為客

戶提供更好設計生態環境的承諾。

台積公司持續提升半導體製程技術，在民國九十九年開發和已提供的製程包括：

- 支援如中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、加速處理器（APU）、場域可程式化閘陣列（FPGA）及高速網路控制器等性能導向之應用的28奈米高效能運算製程技術（28HP）。
- 支援平板電腦、智慧型手機及高端系統單晶片應用的28奈米高效能行動運算製程技術（28HPM）
- 符合主流智慧型手機、平板電腦及數位消費性電子產品需求的28奈米低功耗製程技術（28LP & 28HPL）
- 支援性能導向之應用市場如中央處理器（CPU）、場域可程式化閘陣列（FPGA）、三度空間影像（3D Image）、遊戲機及乙太網路控制器（Gigabit Ethernet）等應用的40奈米泛用型製程技術（40GP）
- 提供手機晶片、應用處理器、家庭娛樂系統、遊戲晶片及無線網路產品解決方案的40奈米低功耗及射頻製程技術（40LP & RF）
- 支援無線區域網路（WLAN）、手機基頻晶片（Cellular BB）、數位電視（DTV）、機頂盒（STB）、藍芽（Bluetooth）、可攜式媒體播放器（PMP）、行動上網裝置（MID）及手持裝置等高端應用的55奈米低功耗射頻技術
- 與客戶共同開發符合高端車用電子應用的65奈米多次可程式非揮發性嵌入式快閃記憶體製程技術
- 支援智慧型手機面板驅動晶片的80奈米高壓製程
- 支援快閃記憶體控制器應用的85奈米低功耗製程
- 符合微控制器晶片應用規格的90奈米嵌入式快閃記憶體技術
- 支援車用電子應用的一次性可程式0.18微米及0.25微米製程技術並已通過驗證
- 0.18微米及0.25微米高精度類比製程技術
- 支援數位電源管理晶片的0.18微米雙極—互補金屬氧化半導體—雙重擴散金屬氧化半導體（BCD）製程技術

此外，台積公司持續開發特殊製程技術，包括背面照度（Back-side Illumination）互補金屬氧化物影像感測器製程（BSI CIS）、90/65 奈米嵌入式快閃記憶體製程及 0.13 微米類比製程。民國九十九年，台積公司更開始提供三維微機電系統（MEMS）平台給無晶圓廠客戶。這些特殊製程技術是台積公司與其他競爭者的重要差異，並能提供客戶更多價值。

民國九十九年，全球半導體市場的產值估計約為美金 2,980 億元，與民國九十八年相較，成長 32%。民國九十九年整體積體電路製造服務業產值約為美金 280 億元，年成長率 43%，佔半導體產業產值的 10%。民國九十九年，專業積體電路製造服務領域的最大市場（依據客戶總部所在地區）為北美地區，佔全球市場的 59%；第二大市場為日本以外的亞太地區，佔 27%；其次為歐洲市場佔 9%；日本市場則佔 5%。

■ 台積公司之市場定位、差異化與策略

➤ 台積公司的市場定位

身為專業積體電路製造服務領域的領導者，台積公司在民國九十九年的合併營收約為美金 133 億元，佔積體電路製造服務領域的 45.5%。依據地區劃分，其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的 67%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔 15%、歐洲市場佔 11%、中國大陸市場佔 3%、日本市場亦佔 4%。依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的 27%、通訊相關產品佔 43%、消費性電子產品佔 13%、工業用等其他產品則佔 17%。

➤ 台積公司的差異化優勢

台積公司在業界的領導地位奠基於「先進技術、卓越製造、客戶夥伴關係」三位一體的差異化競爭優勢。身為技術領導者，台積公司一直以來均為首家致力研發下一世代先進技術的專業積體電路製造服務公司；身為製造領導者，台積公司以優良的良率管理著稱，並提供加速產品上市及量產的最佳支援服務；在客戶夥伴關係上，台積公司也以與客戶緊密無間的合作來提升設計和製造效率。前瞻未來，台積公司將持續藉由三位一體的競爭優勢，提供客戶最有價值的服務。

➤ 台積公司策略

台積公司深信，差異化優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。因此，台積公司致力於保持與提升上述的三大競爭優勢，例如：積極投入 28 奈米和 20 奈米先進製程以保持技術上的領先，成為第一家將這些先進製程導入量產的專業積體電路製造服務業者。

此外，台積公司也不遺餘力地確保製造優勢，例如：不斷提升可製造性設計的支援服務，以提升良率及效率；推出「開放創新平台」，透過設計生態系統介面與由台積公司主動發起或提供支援的設計服務，能有效率地帶動整體半導體業供應鏈每個環節的創新。最後，在客戶夥伴關係上，台積公司每年持續進行客戶評量與調查，以進一步瞭解客戶需要，作為調整服務的參考，加強與客戶的夥伴關係。

為了克服晶圓銷售價格不斷下滑及因應市場上激烈競爭的挑戰，台積公司計劃將繼續強化其核心能力與價值，適切地規劃公司長短期策略，以提高投資報酬率和成長性。

2、最近二年度主要產品別毛利率重大變化說明

不適用。

二、轉投資事業

(一) 轉投資事業概況

截至民國九十九年十二月三十一日止

單位：為新台幣仟元

轉投資事業	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市 價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額（仟股）
				股數（仟股）	股權比例 %				本期認列之投資（損）益（註一）	分配股利	
TSMC Global	一般投資業務	\$42,327,245	\$43,710,543	1	100	\$43,710,543	-	子公司	\$660,931	-	-
TSMC Partners	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務	31,456,130	33,565,775	988,268	100	33,565,775	-	子公司	2,313,657	-	-
世界先進公司	積體電路、大型、超大型積體電路及其零組件之研發、設計、製造、封裝、測試及銷售	13,232,288	9,422,452	628,223	38	7,946,339	9,297,707	採權益法評價之被投資公司	343,252	\$252,228	-
茂迪公司	太陽能電池、太陽能矽晶圓及智慧型測試儀器製造銷售、太陽能發電系統設計架設	6,228,661	6,733,369	76,069	20	4,685,200	（註二）	採權益法評價之被投資公司	542,218	67,774	-
SSMC	積體電路之製造及供應	5,120,028	7,120,714	314	39	6,742,565	-	採權益法評價之被投資公司	1,308,468	-	-
台積電中國子公司	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路	12,180,367	4,252,270	-	100	4,278,014	-	子公司	1,358,492	-	-
TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務	333,718	2,873,888	11,000	100	2,873,888	-	子公司	302,598	-	-
VTAF III	新創科技事業之投資	3,565,441	2,769,423	-	99	2,749,807	-	子公司	(241,178)	-	-
精材公司	晶圓級晶方尺寸之封裝業務	1,357,890	1,645,201	93,081	41	1,632,596	-	具控制力之被投資公司	180,912	9,292	-

創意公司	積體電路元件之研究、開發、生產、測試及銷售	386,568	1,113,516	46,688	35	1,113,516	5,695,919	具控制力之被投資公司	211,199	93,196	-
VTAF II	新創科技事業之投資	1,166,470	1,063,057	-	98	1,057,288	-	子公司	118,200	-	-
TSMC Solar Europe	主要係從事太陽能相關產業之投資業務	25,350	23,971	-	100	23,971	-	子公司	(433)	-	-
Emerging Alliance	新創科技事業之投資	971,785	304,310	-	99	304,310	-	子公司（註三）	2,333	-	-
TSMC Europe	市場行銷業務及工程支援業務	15,749	177,784	-	100	177,784	-	子公司（註三）	38,893	-	-
TSMC Japan	市場行銷業務	83,760	150,312	6	100	150,312	-	子公司（註三）	4,704	-	-
TSMC Solar NA	主要係從事太陽能相關產品之銷售業務	60,962	26,527	1	100	26,527	-	子公司	(35,512)	-	-
TSMC Korea	客戶服務及技術支援業務	13,656	20,929	80	100	20,929	-	子公司（註三）	2,709	-	-
TSMC Lighting NA	主要係從事發光二極體相關產品之銷售業務	3,133	3,133	1	100	3,133	-	子公司	-	-	-

註一：本期認列之投資（損）益業已考量聯屬公司間未實現銷貨利益之影響數。

註二：本公司持有該公司私募之普通股依相關法令規定於三年內不得轉讓。

註三：本期認列之投資（損）益係依該公司同期間未經會計師查核之財務報表計算。

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權情形無。

三、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖期	主要內容/限制條款
合資協議書	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司、新加坡經濟發展局（在民國九十五年九月間，飛利浦公司將其於本合約下之權利義務移轉予已更名為恩智浦之飛利浦半導體股份有限公司。台積公司與恩智浦公司在民國九十五年十一月自新加坡經濟發展局購買其所擁有之全數 SSMC 公司股份後，新加坡經濟發展局已不再為此合資協議書之契約對象。）	於民國八十八年三月三十日生效，得依合約規定終止。	台積公司與飛利浦公司、新加坡經濟發展局同意共同出資於新加坡設立晶圓代工公司 Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)。依約定飛利浦公司（現為恩智浦公司）與台積公司有義務購買 SSMC 特定比例之產能。
技術合作契約	Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. (SSMC)	民國八十八年三月三十日至民國九十三年三月二十九日，任一方未於到期前一年以書面通知他方期滿終止合約者，本合約自動展延五年。	台積公司應移轉特定製程技術予 SSMC，SSMC 則應按其銷貨收入淨額之特定比率支付技術報酬金予台積公司。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十六年十二月二十日至民國一百零六年十二月三十一日	簽約雙方就特定之半導體專利達成交互授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
製造、授權及技術移轉契約	世界先進積體電路股份有限公司	民國九十三年四月一日至民國九十五年三月三十一日，每次合約到期將自動延展一年，直到合約雙方當事人以書面合意決定止。	世界先進公司保留其特定產能予台積公司，並依雙方約定之條件為台積公司製造特定產品。台積公司移轉特定技術予世界先進公司，並向世界先進公司收取權利金作為報酬。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十一年十一月一日至民國一百零一年十月三十一日	簽約雙方就特定之半導體專利達成交互授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
專利授權契約	某跨國公司	民國九十年一月一日至民國一百零一年十二月三十一日	簽約雙方就特定之半導體專利達成交互授權之協議。台積公司應支付權利金予該簽約對象。
修訂研究及發展合作契約	恩智浦公司 (NXP B.V.)	民國九十八年一月一日至民國九十八年十二月三十一日，雙方另可每年合意延展之。	簽約雙方就特定之先進半導體技術達成共同開發之協議。

註：除日常的一般商業交易行為外，本公司目前並無簽訂其他重要契約。另本公司於財務報表中亦揭露「重大承諾及或有事項」，請參閱本公司財務報表。

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行公司債資金運用計畫分析

(一) 資金來源

- 1、目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
- 2、計畫所需資金總額：新台幣 17,000,000 仟元。
- 3、資金來源：發行一百年度第二期無擔保普通公司債新台幣 17,000,000 仟元。
- 4、計畫項目及預定運用進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金金額	預定資金運用進度
			101 年度
			第一季
充實營運資金	101 年第一季	17,000,000	17,000,000

(二) 本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法

- 1、公司名稱：台灣積體電路製造股份有限公司。
- 2、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總額為新台幣壹佰柒拾億元整，每張票面金額新台幣壹仟萬元。
- 3、公司債之利率及計、付息方式：

本公司債利率為固定年利率，五年期 1.29%，七年期 1.46%。自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。以每仟萬元為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

4、公司債發行期限及還本：

本公司債發行期限分為五年期及七年期，到期一次還本。

5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構兆豐國際商業銀行股份有限公司，以備兌付到期本息。

6、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。

7、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣貳佰貳拾伍億元整。

8、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至 100 年 9 月 30 日止，核定股本金額為新台幣貳仟捌佰零伍億元整 (NT\$280,500,000 仟元整)，每股面額新台幣壹拾元 (NT\$10) 整，按面額發行普通股新台幣貳仟伍佰玖拾壹億伍仟壹佰肆拾玖萬貳仟元整 (NT\$259,151,492 仟元整)。

9、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

截至 100 年 9 月 30 日止，該項餘額為新台幣伍仟玖佰貳拾參億捌仟伍佰柒拾陸萬柒仟元整(NT\$592,385,767 仟元整)。

10、證券管理機關規定之財務報表：

請參閱本公開說明書「肆、財務概況」。

11、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為各債權人(以下簡稱債權人)之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予承認，並同意授與受託契約有關受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

13、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用。

14、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

18、附認股權者，其認購辦法：不適用。

19、董事會之議事錄：請參閱第 110 頁。

20、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

21、信用評等：

(1)信用評等機構：中華信用評等股份有限公司

(2)信用評等日期：100.12.6

(3)信用評等結果：twAAA

22、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。

23、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

24、債券形式：

本公司債為記名式，採無實體發行，由台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。

25、還本付息代理機構：

本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權人，並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。

26、通知方式：

有關本公司債應通知債權人之事項，由受託人依相關法令規定辦理。

(三) 本次計劃之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響

1、本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債之計畫發行金額為新台幣 17,000,000 仟元，每張面額為新台幣壹仟萬元，按面額發行。本公司債採未委託證券承銷商對外公開承銷之方式，洽特定人認購，足以確保本次資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

2、本次發行公司債之必要性評估：

本次發行公司債將用於充實中、長期營運資金，以因應公司長期成長所需，適逢國內長期利率水準尚屬低廉，可籌集長期低固定利率資金，故本次發行公司債應屬必要。

3、本次發行公司債之合理性評估：

本次公司債採固定利率發行，五年期利率 1.29%，七年期利率 1.46%，由於目前國內長期利率水準尚屬低廉，故發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

4、分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

(1)各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權籌資工具，前者有普通公司債、銀行借款及國內外轉換公司債等，後者如現金增資及發行美國存託憑證等。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

項目		有利因素	不利因素
債權	普通公司債	1.可取得中、長期穩定之資金。 2.借貸成本相對低廉。 3.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 4.債息列為費用，具節稅效果。 5.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 2.將使負債比率增加。
	銀行借款	1.資金調度運用彈性較大。 2.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 3.債息列為費用，具節稅效果。 4.運用財務槓桿，提高股東權益。	1.較不利於長期資金之取得 2.相較於股權籌資，將形成利息負擔。 3.將使負債比率增加。
	可轉換公司債	1.因附有轉換權利，票面利率較公司債低。 2.相較於股權籌資，可延緩或不造成每股盈餘及股權稀釋。	1.轉換前將使負債比率增加。 2.轉換後將稀釋每股盈餘及股權。
	現金增資	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。

股 權	美國存託憑證(ADR)	1.無利息支出。 2.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新股釋出，致國內流通股數膨脹，對股價產生不利影響。	1.稀釋每股盈餘及股權。 2.無節稅效果。 3.發行成本較高，為達成規模經濟效益，募資額度不宜過低。
--------	-------------	--	--

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘及股權稀釋。由於目前市場利率處於低點，故利息負擔尚屬合理，對每股盈餘無重大影響。

(四) 本次發行價格之訂定方式：依票面金額十足發行。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1、如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者：不適用。

2、如為轉投資其他公司者

(1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

(2)如轉投資特許事業者，應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

3、如為充實營運資金、償還債務者

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A. 債務逐年到期金額及償債計畫：

本公司第五次無擔保普通公司債未償還金額新台幣肆拾伍億元，將於民國 101 年第一季到期一次還本。

本公司一百年度第一期無擔保普通公司債未償還金額新台幣壹佰捌拾億元，甲類五年期公司債之金額壹佰零伍億元，將於民國 105 年第三季到期一次還本，乙類七年期公司債之金額柒拾伍億元，將於民國 107 年第三季到期一次還本。

本次發行甲類五年期公司債之金額壹佰億元，將於民國 106 年到期一次還本。本次發行乙類七年期公司債之金額柒拾億元，將於民國 108 年到期一次還本。本次公司債存續期間之償債款項來源，將以營業收入支應。

B. 預計財務負擔減輕情形：不適用。

C. 目前營運資金狀況：

本公司至 100 年 9 月 30 日止，帳上現金為新台幣 67,150,733 仟元。

D. 所需之資金額度及運用情形：

本公司債發行金額為新台幣壹佰柒拾億元整，用於充實本公司中、長期營運資金。

E. 現金收支預測表

100年度各月份現金收支預測表（註一）

單位：新台幣百萬元

項目	100年1月	100年2月	100年3月	100年4月	100年5月	100年6月	100年7月	100年8月	100年9月	100年10月	100年11月	100年12月
期初現金餘額 1	109,511	97,744	89,186	93,337	96,287	96,296	95,297	33,398	46,124	67,151	65,961	81,838
加：非融資性收入 2												
銷貨收入及其他	30,379	33,719	39,528	37,599	40,884	37,801	35,202	40,175	41,173	32,610	37,489	38,025
利息收入	43	31	40	57	58	81	98	16	39	37	55	89
合計	30,422	33,750	39,568	37,656	40,942	37,882	35,300	40,191	41,212	32,647	37,544	38,114
減：非融資性支出 3												
資本支出及營運支出	47,008	41,567	33,789	33,642	32,830	39,681	43,275	27,329	24,541	18,763	21,549	27,618
長期投資		23	400	87		1	23	2,983	488	4,598		
所得稅支出		138	76		7,203							
利息支出	157	11	13	13	14	13	18	18	17	36	16	24
現金股利							77,730					
合計	47,165	41,739	34,278	33,742	40,047	39,695	121,046	30,330	25,046	23,397	21,565	27,642
要求最低現金餘額 4	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
所需資金總額 5=3+4	72,165	66,739	59,278	58,742	65,047	64,695	146,046	55,330	50,046	48,397	46,565	52,642
融資前可供支用現金餘額(短絀) 6=1+2-5	67,768	64,755	69,476	72,251	72,182	69,483	(15,449)	18,259	37,290	51,401	56,940	67,310
融資淨額 7												
短期借款(還款)	4,976	(569)	(1,139)	(964)	(886)	814	(574)	2,865	588	254	(102)	(248)
子公司資金貸與(償還)							24,421		(13,727)	(10,694)		
公司債發行(償還)									18,000			
合計	4,976	(569)	(1,139)	(964)	(886)	814	23,847	2,865	4,861	(10,440)	(102)	(248)
期末現金餘額 8=1+2-3+7	97,744	89,186	93,337	96,287	96,296	95,297	33,398	46,124	67,151	65,961	81,838	92,062

註一：非合併基礎

101年度各月份現金收支預測表（註一）

單位：新台幣百萬元

項目	101年1月	101年2月	101年3月	101年4月	101年5月	101年6月	101年7月	101年8月	101年9月	101年10月	101年11月	101年12月
期初現金餘額 1	92,062	99,091	96,982	97,521	96,040	94,490	106,071	32,033	46,599	67,293	83,615	101,052
加：非融資性收入 2												
銷貨收入及其他	34,887	33,854	34,438	35,040	37,521	39,862	41,297	42,760	44,536	45,368	45,589	45,313
利息收入	69	69	69	66	66	66	30	30	30	55	55	55
合計	34,956	33,923	34,507	35,106	37,587	39,928	41,327	42,790	44,566	45,423	45,644	45,368
減：非融資性支出 3												
資本支出及營運支出	40,170	33,838	33,870	36,563	31,910	28,323	37,611	28,200	23,565	29,077	28,183	24,301
長期投資	100	2,034										
所得稅支出（註二）		138	76		7,203							
利息支出	157	22	22	24	24	24	24	24	307	24	24	24
現金股利（註二）							77,730					
合計	40,427	36,032	33,968	36,587	39,137	28,347	115,365	28,224	23,872	29,101	28,207	24,325
要求最低現金餘額 4	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
所需資金總額 5=3+4	65,427	61,032	58,968	61,587	64,137	53,347	140,365	53,224	48,872	54,101	53,207	49,325
融資前可供支用現金餘額(短絀) 6=1+2-5	61,591	71,982	72,521	71,040	69,490	81,071	7,033	21,599	42,293	58,615	76,052	97,095
融資淨額 7												
公司債發行(償還)（註三）	12,500											
合計	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末現金餘額 8=1+2-3+7	99,091	96,982	97,521	96,040	94,490	106,071	32,033	46,599	67,293	83,615	101,052	122,095

註一：非合併基礎

註二：暫依一百年數字估列

註三：發行公司債新台幣170億，並償還到期公司債45億

(2)申報(請)年度及預計未來一年度應收帳款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

A. 應收帳款政策及應付帳款政策：

本公司債係用以充實營運資金，對本公司申報年度及預計未來年度應收帳款政策、應付帳款政策並無影響。

B. 資本支出計畫：

本公司民國一百年度資本支出預計約為美金七十三億元。

C. 財務槓桿及負債比率：

	99 年度	100 年度預計
負債比率	18%	18%
財務槓桿度*	1.00	1.00

*財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)

D. 充實營運資金原因：

本次發行公司債將用於充實中、長期營運資金，以因應公司長期成長所需，適逢國內長期利率水準尚屬低廉，可籌集長期低固定利率資金，故本次發行公司債應屬必要。

(3)增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：不適用。

(4)如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。

(5)如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

肆、財務概況

一、財務分析

年 度 分析項目（註 1）		最近五年度財務分析					當年度截至 民國 100 年 9 月 30 日 財務分析
		民國 95 年	民國 96 年	民國 97 年	民國 98 年	民國 99 年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	11.44	11.72	11.87	14.26	18.12	17.92
	長期資金占固定資產比率	228.78	213.63	219.72	196.27	157.73	140.98
償債能力 %	流動比率	451.40	397.94	338.70	256.07	162.88	131.61
	速動比率	404.49	348.53	312.83	228.94	140.07	108.59
	利息保障倍數	204.39	207.51	312.95	669.76	789.71	403.43
經營能力	應收款項週轉率（次）	9.26	8.82	11.08	11.17	10.93	9.85
	平均收現日數	39.40	41.40	32.93	32.66	33.40	37.04
	存貨週轉率（次）	9.27	8.78	10.86	10.06	9.44	9.55
	平均銷貨日數	39.37	41.57	33.59	36.29	38.67	38.20
	應付款項週轉率（次）	15.81	16.05	20.40	18.46	16.89	19.15
	固定資產週轉率（次）	1.38	1.34	1.47	1.12	1.11	0.96
	總資產週轉率（次）	0.55	0.57	0.60	0.49	0.58	0.58
獲利能力	資產報酬率（%）	23.60	19.49	18.35	15.98	25.31	19.18
	股東權益報酬率（%）	26.64	21.94	20.74	18.37	30.23	23.33
	占實收資本比率（%）	營業利益	48.90	42.48	41.48	36.49	54.58
		稅前純益	52.06	45.69	43.22	36.67	57.18
	純益率（%）	40.46	34.81	31.06	31.22	39.71	32.56
	基本每股盈餘（元）（註 2）	4.70	4.04	3.84	3.45	6.24	3.96
	稀釋每股盈餘（元）（註 2）	4.70	4.04	3.81	3.44	6.23	3.96
現金流量	現金流量比率（%）	457.01	397.52	399.16	214.83	188.12	156.38
	現金流量允當比率（%）	153.75	139.35	134.79	122.02	109.98	94.87
	現金再投資比率（%）	14.18	9.73	12.95	6.99	11.20	6.55
槓桿度	營運槓桿度	2.04	2.23	2.50	2.46	2.17	2.50
	財務槓桿度	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達 20% 者可免分析）

1. 負債佔資產比率增加 27%：主要係流動負債中短期借款與應付設備款增加所致。
2. 流動比率減少 36%及速動比率減少 39%：主要係流動負債增加所致。
3. 資產報酬率增加 58%及股東權益報酬率增加 65%：主要係稅後純益增加所致。
4. 營業利益佔實收資本比率增加 64%：主要係營業利益隨銷貨毛利成長而增加所致。
5. 稅前利益佔實收資本比率增加 78%：主要係稅前利益增加所致。
6. 純益率增加 27%：主要係稅後純益增加所致。
7. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘皆增加 81%：主要係稅後純益增加所致。
8. 現金再投資比率增加 60%：主要係營業活動淨現金流量增加所致。

註 1：財務比率計算公式如下：

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／ 平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋現金股利）。

(3)現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）／（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金）。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用）／ 營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／（營業利益－利息費用）。

註2：按盈餘及資本公積轉增資比率(九十五年至九十七年盈餘年度)及員工紅利配股比率(九十五年至九十六年盈餘年度)追溯調整後之每股盈餘。

二、財務報表應記載事項

(一) 最近二年度經會計師查核簽證之財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表)

請參閱第66頁。

(二) 最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表(申報募集發行有價證券已逾年度開始八個月，加列上半年度財務報表)

請參閱第93頁。

(三) 截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表

請參閱第84頁。

三、財務概況應記載事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第 185 條情事者：

截至公開說明書刊印日止無此情事。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一) 財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	民國99年	民國98年	增減金額	增減比率(%)
流動資產	192,234,282	185,831,537	6,402,745	3%
固定資產	366,854,299	254,751,526	112,102,773	44%
其他資產	24,237,329	18,415,746	5,821,583	32%
資產總額	701,239,666	577,426,622	123,813,044	21%
流動負債	118,022,260	72,571,095	45,451,165	63%
長期負債	9,072,488	9,772,815	(700,327)	-7%
負債總額	127,094,748	82,343,910	44,750,838	54%
股本	259,100,787	259,027,066	73,721	0%
資本公積	55,698,434	55,486,010	212,424	0%
保留盈餘	265,779,571	181,882,682	83,896,889	46%
股東權益總額	574,144,918	495,082,712	79,062,206	16%

■ 增減比例超過 20%之變動分析：

固定資產增加：主要係先進製程設備相關之資本支出增加所致。

其他資產增加：主要係存出保證金增加所致。

資產總額增加：主要係固定資產增加所致。

流動負債及負債總額增加：主要係短期借款及應付工程及設備款增加所致。

保留盈餘增加：主要係 99 年度淨利增加所致。

■ 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

■ 未來因應計劃：不適用。

(二) 經營結果

單位：新台幣仟元

項目	民國99年	民國98年	增減金額	變動比例(%)
銷貨收入總額	418,666,448	299,471,214	119,195,234	40%
銷貨退回及折讓	(11,703,136)	(13,728,346)	2,025,210	-15%
銷貨收入淨額	406,963,312	285,742,868	121,220,444	42%
銷貨成本	209,921,268	159,106,619	50,814,649	32%
銷貨毛利	197,042,044	126,636,249	70,405,795	56%
聯屬公司間未實現銷貨毛利	(52,742)	(160,279)	107,537	-67%
已實現銷貨毛利	196,989,302	126,475,970	70,513,332	56%
營業費用	42,142,794	31,953,617	10,189,177	32%
營業利益	154,846,508	94,522,353	60,324,155	64%
營業外收入及利益	15,907,968	4,121,509	11,786,459	286%
營業外費用及損失	1,464,272	3,662,840	(2,198,568)	-60%
稅前利益	169,290,204	94,981,022	74,309,182	78%
所得稅費用	(7,685,195)	(5,763,186)	(1,922,009)	33%
本年度淨利	161,605,009	89,217,836	72,387,173	81%

■ 增減比例超過 20%的變動分析

銷貨收入總額及銷貨收入淨額增加：主要係 99 年度晶圓出貨量增加所致，部分受匯率變動所抵銷。

銷貨成本增加：主要係 99 年度晶圓出貨量增加所致，部分因產能利用率提高而抵銷。

銷貨毛利及已實現銷貨毛利增加：主要係 99 年度晶圓出貨量增加所致。

聯屬公司間未實現銷貨毛利減少：主要係 99 年度第四季銷售予被投資公司之金額減少所致。

營業費用增加：主要係先進製程相關之研究發展費用增加所致。

營業利益增加：主要係已實現銷貨毛利增幅超過營業費用增幅所致。

營業外收入及利益增加：主要係和解賠償收入增加及採權益法認列之投資結果由 98 年之淨損轉為 99 年之淨益所致。

營業外費用及損失減少：主要係採權益法認列之投資結果由 98 年之淨損轉為 99 年之淨益所致。

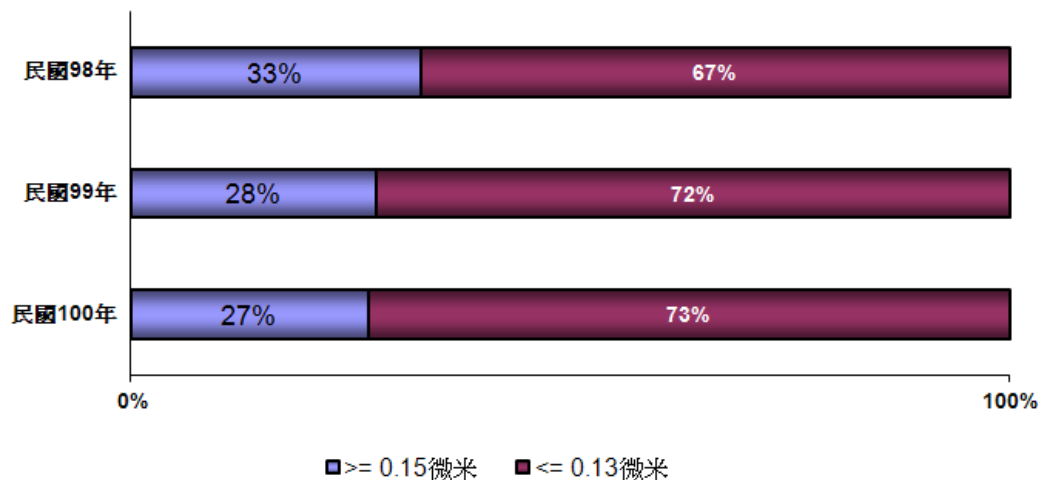
稅前利益增加：主要係營業利益與營業外收入及利益增加所致。

所得稅費用增加：主要係課稅所得增加，部分受稅率下降所影響。

淨利增加：主要係稅前利益增加所致。

■ 預期未來一年銷售數量及其依據

銷售計劃



民國100年晶圓銷售量預期約一千兩百五十萬片約當八吋晶圓

(三) 現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (民國98年12月31日)	全年來自營業活動淨 現金流量 (民國99年)	全年因投資及融資 活動淨現金流量 (民國99年)	現金剩餘數額 (民國99年12月31 日)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
117,043,543	222,023,176	(229,555,589)	109,511,130	-	-

■ 99 年度現金流量變動分析

營業活動之現金流入約 2,220 億：主要係因營業純益及加回無現金支出之折舊及攤銷。

投資活動之現金流出約 1,828 億：主要係用於資本支出。

融資活動之現金流出約 468 億：主要係發放現金股利，然短期借款增加抵銷部分之現金流出。

■ 現金不足額的補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

■ 未來一年現金流動性分析：請參照第 44 頁之現金收支預測表。

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及其資金來源

單位：新台幣仟元

計劃	實際或預計之資金來源	所需資金總額（截至民國99年）	實際或預計之資金運用情形			
			民國96年	民國97年	民國98年	民國99年
生產及廠務設備	自有資金	390,242,212	77,925,776	56,902,459	80,923,392	174,490,585
研發設備	自有資金	24,644,885	5,401,157	1,637,643	6,371,056	11,235,029

預期可能產生效益

基於上述及民國一百年預計之資本支出，民國一百年台積公司產能約增加 190 萬片約當八吋晶圓。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資皆為長期策略性投資；本公司民國九十九年度採權益法之轉投資獲利為新台幣 7,111,443 仟元，較前一年大幅改善，主要原因為來自全球景氣回升與策略性投資綜效所帶來的影響。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

(六) 其他重要事項

無。

伍、特別記載事項

一、委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形

本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

二、委託經行政院金管會證券暨期貨管理局核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告

請參照第 109 頁。

三、證券承銷商評估總結意見

不適用。

四、律師法律意見書

不適用。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見

請參照第 112 頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經證期局通知應補充揭露之事項

無。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者

無。

八、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

本公司董事會由九位在高科技、商務及管理等领域具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成。彼得·邦菲爵士（前英國電信公司執行長）、施振榮先生（前宏基集團董事長）、湯馬斯·延吉布斯先生（前美國德州儀器公司董事長、總經理暨總執行長）、鄒至莊博士（普林斯頓大學教授）以及陳國慈女士（前台積公司資深副總經理暨法務長，目前為中華民國行政院政務顧問及台北市政府市政顧問）五位為獨立董事。在張忠謀董事長領導下，董事會嚴肅對待它的責任，是一個「認真、有能力、獨立」的董事會。

依張董事長對公司治理的理念，董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。為了善盡監督責任，台積公司董事會已建立了各式組織與管道，例如：審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核、內部檢舉系統等。

董事會的第二個責任是指導經營團隊。台積公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告，也花相當多時間與經營階層對話，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整。

董事會的第三個責任，是評量經營團隊之績效及任免經理人。台積公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事會運作情形資訊

張忠謀董事長於民國九十九年共召開四次董事常會以及一次臨時董事會，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	張忠謀	5	0	100%	無
副董事長	曾繁城	5	0	100%	無
董事	行政院 國家發展基金會 代表人：李 鍾熙	3	2	60%	前行政院國家發展 基金管理會代表人 陳添枝先生於民國 99年5月11日辭任。 該會於民國99年8月 6日改派李鍾熙先生 繼任台積公司董事。 陳添枝先生於其中 一次委託出席之臨

					時董事會並經由電話參與會議討論。
董事	蔡力行	5	0	100%	無
獨立董事	彼得・邦菲	4	1	80%	彼得・邦菲爵士於其中一次委託出席之臨時董事會並經由電話參與會議討論。
獨立董事	施振榮	4	1	80%	無
獨立董事	湯馬斯・延吉布斯	4	1	80%	湯馬斯・延吉布斯先生於其中一次委託出席之臨時董事會並經由電話參與會議討論。
其它應記載事項： 一、 證券交易法第十四條之三所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無 二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：無 三、 加強董事會職能之目標：台積公司相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，本公司成立了審計委員會及薪酬委員會，以協助董事會執行其職責。					

註：民國一百年六月九日，本公司股東會增選鄒至莊先生及陳國慈女士為獨立董事。

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

至民國一百年九月底止，台積公司審計委員會由全體五位獨立董事組成並聘任一位財務專家。審計委員會組織章程請參考本公司網站。

審計委員會運作情形資訊

審計委員會主席邦菲爵士於民國九十九年度共召開四次常會及五次臨時會。審計委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	彼得·邦菲	9	0	100%	無
獨立董事	施振榮	8	1	89%	無
獨立董事	湯馬斯·延吉 布斯	9	0	100%	無
財務專家	羅貝茲	9	0	100%	無

其他應記載事項：

- 一、證券交易法第十四條之五所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）

說明：（一）本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國九十九年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

（二）本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國九十九年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

註：民國一百年六月九日，本公司股東會增選鄒至莊先生及陳國慈女士為獨立董事。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 (一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 (二) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 (三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司責成包括企業訊息處、股務、法務等相關部門處理股東建議或糾紛等事宜。 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股情形。 本公司已依法令於本公司內部控制制度及「關係企業管理辦法」中建立相關控管。	無
二、董事會之組成及職責 (一) 公司設置獨立董事之情形 (二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	彼得·邦菲爵士、施振榮先生、湯馬斯·延吉布斯先生、鄒至莊先生以及陳國慈女士等五位為本公司獨立董事。 本公司由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性。	無
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司視不同狀況，責成包括企業訊息處、股務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。	無
四、資訊公開 (一) 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司透過本公司網站 (http://www.tsmc.com) 隨時揭露相關資訊。 本公司美國存託憑證 (ADR) 在美國紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易，為外國發行人，須遵守NYSE相關規定。其中，本公司須依據NYSE上市準則，揭露本公司公司治理執行情形與美國國內公司執行情形之重大差異，有關上述資訊之揭露	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	請參考以下網址： http://www.tsmc.com/download/english/eo3_governance/NYSE_Section_303A.pdf 本公司責成企業訊息處、股務等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊。 本公司依規定設有發言人。 本公司法人說明會提供網路現場直播。	
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司設有審計委員會及薪酬委員會，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第52至65頁)。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形： 本公司未訂定公司治理實務守則，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本公開說明書「公司治理」說明(第52至65頁)。		

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）： （一）員工權益、僱員關懷之執行情形：請參閱本公司民國99年年報「員工」說明（第56-58頁） （二）投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利之執行情形：請參閱本公司民國99年年報「企業社會責任」說明（第71-77頁） （三）風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司民國99年年報「風險管理」說明（第65-69頁）。 （四）客戶政策之執行情形：請參閱本公司民國99年年報「客戶夥伴關係」說明（第54-55頁）。 （五）本公司已為董事及經理人購買責任保險。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無 民國九十九年，台積公司榮獲Corporate Governance Asia雜誌頒發台灣地區「2010年亞洲年度公司治理獎」，以及被FinanceAsia雜誌評等為台灣地區「最佳公司治理」之公司。	

(四) 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。至民國一百年九月底止，本公司薪酬委員會由全體五位獨立董事組成。薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

薪酬委員會主席施振榮先生於民國九十九年度共召開四次常會，薪酬委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	施振榮	3	75%	無
委員	張忠謀	4	100%	不具表決權之委員
委員	彼得·邦菲	4	100%	無
委員	湯馬斯·延吉布斯	4	100%	無

註：行政院金融監督管理委員會依據新修訂之證券交易法授權，於民國一百年三月十八日訂定「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，本公司董事會於民國一百年八月九日通過修訂本公司薪酬委員會組織章程以符合上述辦法之規定，並選任全體五位獨立董事（施振榮先生、彼得·邦菲爵士、湯馬斯·延吉布斯先生、鄒至莊先生以及陳國慈女士）為薪酬委員會委員。

(五) 履行社會責任情形

台積公司堅信，所謂「企業社會責任」就是成為促使社會向上提昇的力量。從「倫理、商業道德、經濟、法治、環保」這五方面，落實一己之力，樹立安定社會的力量，促使更多人起而效尤，社會亦能因此進步。

我們的社會願景是一個「共創永續發展、公平正義、安居樂業的社會」。台積公司實踐企業社會責任的十項原則，是我們持續為社會帶來正向發展的重要圭臬：

1. 堅持誠信正直，對股東、員工、及社會大眾皆同。
2. 遵守法律、依法行事、絕不違法。
3. 反對貪腐，拒絕裙帶關係；不賄賂、也不搞政商關係。
4. 重視公司治理，力求在股東、員工及所有利益關係人之間達到利益均衡。
5. 不參與政治。
6. 提供優質工作機會，包括良好的待遇、具有高度挑戰的工作內容，及舒適安全的工作環境，以照顧員工的身心需求。
7. 因應氣候變遷，重視並持續落實環境保護措施。
8. 強調並積極獎勵創新，並充分管控創新改革的可能風險。
9. 積極投資發光二極體照明以及太陽能等綠能產業，為環保節能盡一份心力。
10. 長期關懷社區，並持續贊助教育及文化活動。

台積公司對所有利益關係人善盡社會責任，經由實踐上述原則，客戶會因為台

積的誠信、守法，以及良好的公司治理而更加信賴；投資人會因為公司明確的核心價值而更願意長期投資；全體員工也會基於對公司價值觀的認同，進而產生更強的向心力。如此落實企業社會責任，將為台積帶來更大競爭優勢，為股東創造更高的價值，並為公司所有關係人開創多贏。

在企業的「倫理」部分，台積公司堅持誠信正直，反對貪腐，不賄賂、不搞政商關係，同時提供員工優良的工作環境，重視員工工作與生活的平衡；我們倡導減少不必要的會議、改善作業流程，主管以身作則，員工工作效率提高、工時減少，提供員工一個平衡健康的工作環境。在企業的「商業道德」方面，除堅守上述倫理的要件之外，台積公司堅持良好的公司治理，營運透明，信守對所有利益關係人的承諾。

在企業的「經濟」責任方面，由於台積公司對公司治理的堅持，加上良好的公司營運，提供社會優質的工作機會，並積極鼓勵創新，為社會創造價值；同時，積極投入社會公益，贊助教育及文化活動。在「法治」責任方面，我們除了遵守法律外，更以最高的倫理和商業道德標準檢視自我。

在企業的「環保」責任方面，因應氣候、環境與生態的改變，做好環境保護、珍惜地球資源，產業界的努力尤其重要，台積公司更是責無旁貸。台積公司在為所有利益關係人創造價值的同時，堅守對環境永續發展的承諾，矢志成為全球產業界的模範，樹立標竿。2010年，台積公司向綠能產業跨出關鍵性的一步，太陽能廠及固態照明廠分別於台中及新竹動土興建，台積公司期許，在藉此綠能產業為地球善盡心力的同時，也能為公司、為股東創造利益。

過去以來，台積公司經由全體同仁兢兢業業的努力，在公司治理、營運、投資人關係、員工福利、環保績效等各方面，獲得多項肯定。展望未來，台積公司將更加深耕並落實上述企業社會責任的原則，為公司所有關係人開創多贏，亦為社會創造更美好的將來。

履行社會責任情形

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理 (一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。 (二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。 (三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	請參考以上所述。 本公司遵循董事長訂定之企業社會責任十大原則，各單位將企業社會責任的觀念融入各自負責之日常運作中，與利害關係人之溝通藉由個別管道定期或不定期收集其關切議題，各單位再將此些議題評估分析後，將重要議題納入執行計畫及日常運作中。 台積公司從業道德規範要求台積公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉本規範為核心價值。公司之經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範；公司之經理人特別是執行長、財務長及法務長，在董事會之監督下，負責在向主管機關及投資大眾揭露之財務報表帳冊中，完整、公允、準確、及時且清楚地表達揭露公司財務會計資訊。公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。 同仁當發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員或管道提出報告：直屬主管、人力資源最高主管、員工申訴直通車、或審計委員會之主席。台積公司針對任何違反本規範之同仁，將根據公司獎懲辦法予以處分，包括解僱處分。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
二、發展永續環境 (一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。 (二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。 (三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。 (四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	台積公司各晶圓廠均設置空氣及水污染防治設備，並符合法排放標準。此外，各種污染防治設備亦擁有緊急電源在內的備援設計，以確保萬一運轉中發生部分設備故障時，仍可由備援系統作為替代，降低污染物異常排放的風險。台積公司也將所有水污染防治、空氣污染防治設備的運轉狀況，納入中央監控系統，由每日二十四小時的輪值人員監控，並將系統效率檢知資訊列入重點追蹤項目，以確保空氣及廢水的排放品質。 台積公司新廠區的製程用水回收率皆達 85%以上，符合或優於科學工業園區管理局所訂定的標準，亦優於國際間半導體廠製程用水回收率。此外，台積公司對於削減非製程用水也不遺餘力，例如減少空調用水、衛生設施使用回收水、管控外牆清洗與景觀澆灌用水與節約廚房用水等。我們亦使用公司內部網站系統，量測與收集全公司之水回收與重複使用量（如製程水回收）。 台積公司成立專責單位統籌管理廢棄物。為了達到資源永續利用，台積公司對於廢棄物的管理，首重製程減廢，其次考量委外再利用或處理。為確實掌握廢棄物的流向，台積公司慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，並且訂有年度稽核計劃，確認其證照文件、現場操作情形與行車路徑動向，確保所有廢棄物均經合法妥善處理或再利用，避免造成二次環境污染。民國九十九年度，台積公司之廢棄物回收率為 92%，已達成 90%的目標，同時，衛生掩埋的比例亦降低至 1%以下。 對於新建廠房及辦公室建築物設計，台積公司採用台灣「綠建築標準」及美國「節能環保設計標準」（LEED），較傳統之設計將更為節省能資源。同時，台積公司自民國九十七年開始逐年改善現有之辦公室建築物，以符合美國 LEED 標準。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
三、維護社會公益 (一) 公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。 (二) 公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	台積公司除遵守相關勞動法規與保障員工合法權益之外，為維持順暢的雙向溝通管理與交流，台積公司定期舉辦跨階層會議、各層級主管溝通會、員工滿意度調查，以及雙周發行工作與生活資訊兼具的電子晶園雜誌。亦提供公司內部公正並暢通之員工申訴機制與員工意見反映管道，以傾聽與解決員工的各項意見與想法，包含： ■ 針對重大管理、財務、稽核等各項問題之機密申訴管道如下： (1) 由董事會下所設之具獨立性之審計委員會。 (2) 由一名副總經理親自負責之「員工申訴直通車」。 ■ 針對工作與環境一般性意見：員工關係部負責之員工意見反映管道。 ■ 針對個人工作與生活上之相關議題：電話服務中心與廠區關懷小組。 台積公司持續推動許多員工福利、員工關懷、員工獎勵、員工溝通等方案，提供員工一個兼具挑戰性、有樂趣的工作環境。 ■ 設立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行。包括：社團活動、藝文講座、員工旅遊、運動會、家庭日，以及節慶、婚喪喜慶、急難救助等補助。 ■ 提供員工餐廳、洗衣服務、旅遊、銀行、剪髮服務及租屋、通勤協助，以滿足同仁在公司內的便利需求。 ■ 提供各項健康促進與心理諮商方案，關懷員工身心福祉。 ■ 設置台積運動館，提供各式的健身設施給全體員工及其眷屬使用，以促進健康的生活品質。此外，並於新竹及台南廠區設立附設托兒所，照顧員工育兒需求。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。 (四) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。 (五) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	台積公司定期舉辦年度客戶滿意度調查，以確保客戶的需求得到了了解與妥善照應，並達成高滿意度的服務。此滿意度調查係由中立第三者顧問公司透過網路或訪談來進行，台積公司針對客戶的意見提出改善計劃，並制訂有效的回報系統。 台積公司集合晶圓廠、資材管理、風險管理，以及品質系統管理等單位組成內部的委員會，致力於供應鏈管理。而委員會的主要任務為降低供應鏈風險及改善供應鏈。委員會包含一位資深副總及多位主管，訂定年度計劃及每季查核執行進度，並設置工作小組，與供應商分享風險管理的案例，協助供應商改善和提升品質系統、綠色採購、環境保護和工廠安全，同時，我們定期與供應商溝通，或經由公開的資訊，持續不斷地監控主要供應商的財務狀況及整體供應鏈的庫存變化，並備妥應變方案以降低風險。工作小組每個月定期開會追蹤各專案的進度，並積極解決供應商的問題。其他詳細內容請參考本公司網站企業社會責任相關資訊。 台積電文教基金會持續投入資源，開啟「高中物理實驗學程」、更新國立自然科學博物館「半導體的世界」展館，及開創「台積科學之旅」等多項專案，以推動科普知識，鞏固科學教育基礎。除教育文化紮根的耕耘不輟，台積電文教基金會亦持續支持「台積志工社」，號召台積同仁以實際行動關懷社區弱勢，擴大企業對社會的關懷。	
四、加強資訊揭露 (一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	台積公司自民國九十七年起每年均發行「企業社會責任報告」，同時亦取得第三者驗證，符合 GRI G3 A+及 AA1000AS:2008 標準要求。並自民國九十八年起，連續三年獲頒台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續報告獎」的最高榮譽--製造業組金獎。	無

項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司未訂定企業社會責任守則，有關本公司企業社會責任運作情形，請參閱本公司網站企業社會責任相關資訊，網址：http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm	
	六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 請參考本公司網站企業社會責任相關資訊，網址：http://www.tsmc.com/chinese/csr/index.htm	
	七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： （一）台積公司取得積體電路產品碳足跡驗證以及第三類環保產品標章，符合 PAS2050 與 ISO14025 標準。 （二）台積公司「企業社會責任報告」符合 GRI G3 A+及 AA1000AS:2008 標準要求。	

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施

1. 道德價值

誠信正直一直是台積公司文化最重要之核心價值。台積公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，並隨時自我警惕，以誠信、正直、準確且透明的精神，實踐我們所說及所從事之作為。

維護台積公司之道德價值及名譽，是台積公司每一份子的重要責任。因此，台積公司從業道德規範（以下稱「本規範」）要求台積公司每一個人必須做到：避免造成因個人利益而犧牲公司利益或與公司利益有所衝突；迴避任何賄賂、不公平競爭、舞弊、浪費及任何濫用公司資源情形；不得從事任何不利於公司、環境及社會的行為；遵守所有法令規範及立法精神；避免任何不當影響任何人決定之行為，任何人包括政府官員、公務員、法院、客戶、供應商及承包商。

為了建立一個持續創新、技術領先以及獲利成長的環境，我們致力於倡導在永遠尊重台積公司及客戶等之智慧財產權、財產權以及營業秘密的基礎上建立的業務關係，以及適當使用公司資產，不移作個人用途。

本規範並要求台積公司所有同仁、經理人和董事會成員均應信奉本規範為核心價值。公司之經營階層必須建立一重視道德誠信從業行為之良好典範；公司之經理人特別是總執行長、財務長及法務長，在董事會之監督下，負責在向主管機關及投資大眾揭露之財務報表帳冊中，完整、公允、準確、及時且清楚地表達揭露公司財務會計資訊。

2. 從業行為管理及懲處

公司所有同仁、經理人及主管均必須遵守本規範及相關辦法之規定。台積公司期待公司的客戶、供應商、承包商、顧問及其他有契約關係之合作夥伴了解並尊重台積的道德標準及文化。

同仁當發現或合理懷疑有任何違反本規範之情形時，必須立即根據違反情形向以下之人員或管道提出報告：直屬主管、人力資源最高主管、員工申訴直通車、或審計委員會之主席。

台積公司針對任何違反本規範之同仁，將根據公司獎懲辦法予以處分，包括解僱處分。

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章者之查詢方式

本公司未訂定公司治理實務守則，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本說明書「公司治理」說明（第 52 至 65 頁）。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總

無。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊

無。

會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣積體電路製造股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。另自民國九十七年一月一日起，採用財團法人中華民國會計研究發展基金會新發佈之（九六）基秘字第○五二號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」及行政院金融監督管理委員會發佈之相關規定。

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十八年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之

查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具附說明段說明採用新修訂存貨會計處理準則暨採用員工分紅及董監酬勞會計處理之修正式無保留查核意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 九 年 一 月 二 十 二 日

台灣積體電路製造股份有限公司



民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
	金 額 %	金 額 %
4110 銷貨收入總額（附註二及二四）	\$ 299,471,214	\$ 330,228,027
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）	13,728,346	8,460,944
4100 銷貨收入淨額	285,742,868 100	321,767,083 100
5110 銷貨成本（附註三、九、十八及二四）	159,106,619 56	183,589,540 57
5910 銷貨毛利	126,636,249 44	138,177,543 43
5920 聯屬公司間已（未）實現銷貨毛利（附註二）	(160,279) -	72 -
已實現銷貨毛利	126,475,970 44	138,177,615 43
營業費用（附註十八及二四）		
6300 研究發展費用	19,688,032 7	19,737,038 6
6200 管理費用	10,238,131 3	9,895,617 3
6100 行銷費用	2,027,454 1	2,254,728 1
6000 合 計	31,953,617 11	31,887,383 10
6900 營業利益	94,522,353 33	106,290,232 33
營業外收入及利益		
7480 和解賠償收入（附註二七）	1,464,915 1	951,180 -
7110 利息收入（附註二）	1,117,374 -	2,728,892 1
7310 金融商品評價淨益（附註二、五及二三）	587,151 -	- -
7480 技術服務收入（附註二四及二七）	375,118 -	619,237 -
7140 處分金融資產淨益（附註二及二三）	53,364 -	452,159 -
7160 兌換淨益（附註二）	- -	1,113,406 1

（接次頁）

(承前頁)

		九	十	八	年	度	九	十	七	年	度
代 碼		金		額		%	金		額		%
7121	採權益法認列之投資淨益(附註二及十)	\$		-		-	\$		72,568		-
7480	其他收入（附註二及二四）			523,587		-			788,183		-
7100	合 計			4,121,509		1			6,725,625		2
營業外費用及損失											
7521	採權益法認列之投資淨損(附註二及十)			2,695,720		1			-		-
7560	兌換淨損（附註二）			630,455		-			-		-
7510	利息費用			142,026		-			355,056		-
7640	金融商品評價淨損（附註二、五及二三）			-		-			1,230,966		1
7630	金融資產減損損失(附註二及十一)			-		-			247,488		-
7630	閒置資產損失（附註二）			-		-			210,477		-
7880	其他損失（附註二）			194,639		-			213,052		-
7500	合 計			3,662,840		1			2,257,039		1
7900	稅前利益			94,981,022		33			110,758,818		34
8110	所得稅費用（附註二及十七）			5,763,186		2			10,825,650		3
9600	本年度淨利	\$		89,217,836		31	\$		99,933,168		31
代 碼		稅		前	稅	後	稅		前	稅	後
每股盈餘（附註二二）											
9750	基本每股盈餘	\$		3.68	\$	3.45	\$		4.25	\$	3.84
9850	稀釋每股盈餘	\$		3.67	\$	3.44	\$		4.22	\$	3.81

假設九十七年度子公司持有母公司股票不視為庫藏股票而作為備供出售金融資產時之擬制資料(稅後金額,附註二及二一):

	九 十 七 年 度
本年度淨利	\$ 100,035,447
每股盈餘	
基本每股盈餘	\$ 3.84
稀釋每股盈餘	\$ 3.81

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十二日查核報告)

董事長:

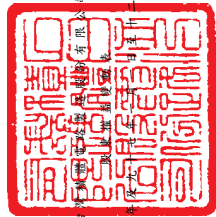


經理人:



會計主管:





台灣證券交易所股份有限公司

民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股股利為元									
普	通	股	發	行	股	本	額	資	本
股數 (千股)	26,427,104	金	264,271,037	額	額	額	額	額	額
九十七年一月一日餘額									
盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	-	10,917,709	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	237,693	-	-
員工現金紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工股票紅利	393,988	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	51,254	-	-	-	-	-	-	-	-
股票股利—每股 0.02 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事酬勞	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積補充資本	76,881	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按權益法認列被投資公司金融商品未實現損益之調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工行使認股權發行新股	6,027	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司獲配母公司現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備出出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按權益法認列被投資公司金融商品未實現損益之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股票交易—買回已發行普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
註銷庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七年十二月三十一日餘額	25,625,437	-	-	-	67,324,593	391,857	102,337,417	481,138	-
盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	51,251	-	-	-	-	-	-	-	-
股票股利—每股 0.02 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工股票紅利	141,870	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積補充資本	76,876	-	-	-	-	-	-	-	-
九十八年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按權益法認列被投資公司金融商品未實現損益之調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員工行使認股權發行新股	7,272	-	-	-	-	-	-	-	-
備出出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按權益法認列被投資公司金融商品未實現損益之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十八年十二月三十一日餘額	25,902,706	-	-	-	77,317,710	-	104,564,972	181,882,682	-
註：九十八及九十七年度員工紅利及董事酬勞分別為 6,771,338 千元及 15,148,057 千元，業已自當年度淨利中扣除。									
後附之附註係本財務報表之一部分。									
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十二日查核報告)									



董事長：



經理人：



會計主審：

台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$ 89,217,836	\$ 99,933,168
折舊及攤銷	74,327,868	74,569,562
聯屬公司間未（已）實現銷貨毛利	160,279	(72)
金融資產折溢價攤銷數	6,322	(97,381)
金融資產減損損失	-	247,488
處分備供出售金融資產淨益	(37,370)	(443,404)
持有至到期日金融資產被贖回利益	(16,091)	-
處分以成本衡量之金融資產淨損（益）	97	(8,755)
採權益法認列之投資淨損（益）	2,695,720	(72,568)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,402,592	1,804,351
處分固定資產及其他資產淨益	(138,613)	(298,769)
提列閒置資產損失	-	210,477
遞延所得稅	(1,678,381)	2,361,261
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	(222,901)	(164,405)
應收關係人款項	(10,813,569)	14,973,444
應收票據及帳款	(8,443,344)	6,470,152
備抵呆帳	(5,746)	(252,226)
備抵退貨及折讓	2,715,050	2,011,897
其他應收關係人款項	235,470	43,835
其他金融資產	(392,317)	(380,057)
存 貨	(6,022,280)	8,179,206
預付費用及其他流動資產	290,470	(330,664)
應付帳款	4,925,758	(5,171,553)
應付關係人款項	836,992	(1,797,280)
應付所得稅	(461,691)	(1,766,153)
應付薪資及獎金	7,075,402	(30,280)
應付員工紅利及董事酬勞	(881,731)	15,148,057
應付費用及其他流動負債	1,259,544	(3,112,220)
應計退休金負債	97,167	52,330
遞延貸項	(230,487)	(129,494)
營業活動之淨現金流入	<u>155,902,046</u>	<u>211,949,947</u>

（接次頁）

(承 前 頁)

	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 86,970,843)	(\$ 56,766,192)
購買備供出售金融資產	-	(23,697,000)
購買持有至到期日金融資產	(10,803,805)	(12,371,965)
採權益法之長期股權投資增加	(320,443)	(494,765)
購買以成本衡量之金融資產	(1,411)	(20,681)
合併子公司取得現金數	-	270,650
處分備供出售金融資產價款	1,037,370	45,584,934
持有至到期日金融資產領回	6,293,000	15,004,000
處分以成本衡量之金融資產價款	18,828	10,606
被投資公司減資退回股款	27,753	2,465,293
處分固定資產及其他資產價款	71,850	2,042,899
遞延借項增加	(1,347,228)	(3,199,813)
存出保證金減少	<u>21,621</u>	<u>21,801</u>
投資活動之淨現金流出	(<u>91,973,308</u>)	(<u>31,150,233</u>)
融資活動之現金流量：		
償還公司債	(8,000,000)	-
存入保證金減少	(477,776)	(761,525)
員工行使認股權發行新股	260,533	227,150
現金股利	(76,876,312)	(76,881,311)
員工現金紅利	-	(3,939,883)
董事酬勞	-	(176,890)
買回庫藏股票	<u>-</u>	(<u>33,480,997</u>)
融資活動之淨現金流出	(<u>85,093,555</u>)	(<u>115,013,456</u>)
現金及約當現金淨增加（減少）數	(21,164,817)	65,786,258
年初現金及約當現金餘額	<u>138,208,360</u>	<u>72,422,102</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$117,043,543</u>	<u>\$138,208,360</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ 351,803</u>	<u>\$ 355,056</u>
支付所得稅	<u>\$ 7,791,196</u>	<u>\$ 10,282,464</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

	九 十 八 年 度	九 十 七 年 度
同時影響現金及非現金項目之投資及融資活動：		
購置固定資產價款	\$108,592,471	\$ 58,951,343
應付工程及設備款增加	(21,620,819)	(2,185,151)
換出資產抵減價款	(809)	-
支付現金金額	<u>\$ 86,970,843</u>	<u>\$ 56,766,192</u>
處分固定資產及其他資產價款	\$ 64,390	\$ 2,051,168
其他應收關係人款項減少 (增加)	8,269	(8,269)
換出資產抵減價款	(809)	-
取得現金金額	<u>\$ 71,850</u>	<u>\$ 2,042,899</u>
買回庫藏股票	\$ -	\$ 30,427,413
應付費用及其他流動負債減少	-	3,053,584
支付現金金額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33,480,997</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8,000,000</u>
一年內到期之其他長期應付款 (帳列應付費用及其他流動負債)	<u>\$ 769,144</u>	<u>\$ 1,026,421</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年一月二十二日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣積體電路製造股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

台灣積體電路製造股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具標準式無保留意見之查核報告及附說明段說明採用新修訂存貨會計處理準則之修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



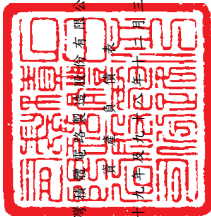
黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 二 十 四 日



台灣國際建設股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟
每股面額為元

代碼	資產	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日	代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
		金額	%			金額	%
1100	流動資產			2100	短期借款(附註十四)	\$ 30,908,637	4
1310	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 109,511,130	15	2180	公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、五及二三)	-	-
1320	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、五及二三)	-	-	2140	應付帳款	7,834	-
1330	備供出售金融資產(附註二、六及二三)	3,918,274	-	2150	應付關係人款項(附註二四)	10,559,283	2
1340	持有至到期日金融資產(附註二、七及二三)	4,796,589	1	2160	應付所得稅(附註二及十八)	2,574,450	-
1150	應收關係人款項(附註二四)	25,733,974	4	2171	應付薪資及獎金	7,108,869	1
1143	應收票據及應款	22,541,773	3	2219	應付員工福利及董事酬勞(附註二及二十)	5,287,751	1
1149	應收票據(附註二及八)	19,884,520	3	2224	應付工程及設備款	8,671,338	1
1148	備抵退貨及折讓(附註二及八)	(488,000)	-	2170	應付費用及其他流動負債(附註十六及二三)	10,959,469	2
1180	其他應收關係人款項(附註二四)	(7,341,444)	(1)	21XX	流動負債合計	41,992,198	6
1190	其他金融資產(附註二五)	1,302,281	-			8,623,769	1
1210	存貨(附註二、三及九)	415,206	-			118,022,260	12
1286	遞延所得稅資產(附註二及十八)	25,646,575	4	2410	長期負債	-	-
1298	遞延所得稅資產(附註二及十八)	5,133,775	1	2440	應付公司債(附註十五及二三)	4,500,000	1
11XX	流動資產合計	192,234,282	27	24XX	其他長期應付款(附註十六及二三)	416,390	-
					長期負債合計	4,916,390	1
1421	長期投資(附註二、六、七、十、十一及二三)						
1450	採權益法之長期股權投資	114,977,174	17	2810	其他負債	-	-
1450	備供出售金融資產	1,033,049	-	2820	應計退休金負債(附註二及十七)	3,824,601	1
1460	持有至到期日金融資產	1,405,698	-	2881	存入保證金(附註二七)	1,001,376	-
1480	以成本衡量之金融資產	492,835	-	28XX	遞延貨項(附註二及二四)	47,873	-
14XX	長期投資合計	117,913,726	17		其他負債合計	4,856,425	1
				2XX	負債合計	127,094,748	14
1521	固定資產(附註二、十二及二四)						
1531	本						
1561	建築物	128,646,942	18	3110	股本(附註二十)	-	-
1561	機器設備	852,733,592	122		普通股股本—每股面額10元	-	-
15X1	辦公設備	11,730,537	2		額定—28,050,000 仟股	-	-
15X9	累積折舊	(993,111,071)	(142)		發行—一九九九年25,910,078 仟股	-	-
1670	預付款項及未記工程	(706,605,445)	(101)		一九八八年25,902,706 仟股	-	-
15XX	固定資產合計	80,348,673	11	32XX	資本公積(附註二及二十)	259,100,787	37
		366,854,299	52		保留盈餘(附註二及二十)	55,698,434	8
1760	無形資產			3310	法定盈餘公積	86,239,494	12
1780	商譽(附註二)	1,567,756	-	3320	特別盈餘公積	1,313,047	-
17XX	遞延借項—淨額(附註二及十三)	54,564,422	1	3350	未分配盈餘	178,227,030	26
	無形資產合計	7,024,183	1	33XX	保留盈餘合計	265,779,571	38
1860	其他資產				股東權益合計	(6,543,163)	(1)
1820	遞延所得稅資產(附註二及十八)	7,154,266	1	3420	累積換算調整數	(6,543,163)	(1)
1880	存出保證金	8,638,749	2	3450	金融商品未實現利益	109,289	-
18XX	其他(附註二及二四)	1,420,131	-	34XX	股東權益其他項目合計	(6,433,874)	(1)
	其他資產合計	17,213,146	3	3XXX	股東權益合計	574,144,918	82
1XXX	資產總計	\$ 701,239,666	100		負債及股東權益總計	\$ 701,239,666	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)



董事長：

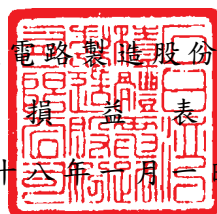


經理人：



會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	九	十	九	年	度	九	十	八	年	度
	金		額	%		金		額	%	
4110 銷貨收入總額（附註二及二四）			\$ 418,666,448					\$ 299,471,214		
4170 銷貨退回及折讓（附註二及八）			<u>11,703,136</u>					<u>13,728,346</u>		
4100 銷貨收入淨額			406,963,312	100				285,742,868	100	
5110 銷貨成本（附註三、九、十九及二四）			<u>209,921,268</u>	<u>52</u>				<u>159,106,619</u>	<u>56</u>	
5910 銷貨毛利			197,042,044	48				126,636,249	44	
5920 聯屬公司間未實現銷貨毛利（附註二）			<u>52,742</u>	<u>-</u>				<u>160,279</u>	<u>-</u>	
已實現銷貨毛利			<u>196,989,302</u>	<u>48</u>				<u>126,475,970</u>	<u>44</u>	
營業費用（附註十九及二四）										
6300 研究發展費用			27,623,299	7				19,688,032	7	
6200 管理費用			11,681,756	3				10,238,131	3	
6100 行銷費用			<u>2,837,739</u>	<u>-</u>				<u>2,027,454</u>	<u>1</u>	
6000 合計			<u>42,142,794</u>	<u>10</u>				<u>31,953,617</u>	<u>11</u>	
6900 營業利益			<u>154,846,508</u>	<u>38</u>				<u>94,522,353</u>	<u>33</u>	
營業外收入及利益										
7121 採權益法認列之投資淨益（附註二及十）			7,111,443	2				-	-	
7480 和解賠償收入（附註二七）			6,939,764	2				1,464,915	1	
7110 利息收入			764,027	-				1,117,374	-	
7480 技術服務收入（附註二四及二七）			446,746	-				375,118	-	

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7310	金融商品評價淨益（附註二、五及二三）	\$ 312,862	-	\$ 587,151	-
7480	其他收入（附註二及二四）	333,126	-	576,951	-
7100	合 計	15,907,968	4	4,121,509	1
	營業外費用及損失				
7530	處分固定資產損失（附註二）	838,750	-	58,242	-
7510	利息費用	214,641	-	142,026	-
7880	災害損失（附註九）	190,992	-	-	-
7560	兌換淨損（附註二）	58,737	-	630,455	-
7521	採權益法認列之投資淨損（附註二及十）	-	-	2,695,720	1
7880	其他損失（附註二）	161,152	-	136,397	-
7500	合 計	1,464,272	-	3,662,840	1
7900	稅前利益	169,290,204	42	94,981,022	33
8110	所得稅費用（附註二及十八）	7,685,195	2	5,763,186	2
9600	本年度淨利	\$ 161,605,009	40	\$ 89,217,836	31
代 碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基本每股盈餘	\$ 6.53	\$ 6.24	\$ 3.68	\$ 3.45
9850	稀釋每股盈餘	\$ 6.53	\$ 6.23	\$ 3.67	\$ 3.44

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告）

董事長：

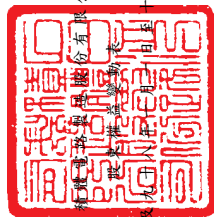


經理人：



會計主管：





台灣電力股份有限公司

電力事業部

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

普 通 股	發 行 股 本 額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	股 東 權 益	其 他 項 目	股 東 權 益 合 計
股 數 (仟 股)	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
25,625,437	\$ 256,254,373	\$ 49,875,255	\$ 67,324,393	\$ 391,857	\$ 102,337,417	\$ 170,053,667	\$ 481,158	\$ 287,342	\$ 476,377,111
盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	9,993,317	-	(9,993,317)	-	-	-	-
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(391,857)	391,857	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	(76,876,312)	(76,876,312)	-	-	(76,876,312)
股票股利—每股 0.02 元	51,251	-	-	-	(512,509)	(512,509)	-	-	-
員工股票紅利	141,870	1,418,699	6,076,289	-	-	-	-	-	7,494,988
資本公積撥充資本	76,876	768,763	-	-	-	-	-	-	-
九十八年度淨利	-	-	-	-	89,217,836	89,217,836	-	-	89,217,836
採權益法認列股權比例變動之調整	-	-	-	-	-	-	-	-	115,418
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(2,247,825)	-	(2,247,825)
員工行使認股權發行新股	7,272	72,722	187,811	-	-	-	-	-	260,533
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	14,014	14,014
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	726,949	726,949
九十八年十二月三十一日餘額	25,902,706	55,486,010	77,317,710	-	104,564,972	181,882,682	(1,766,667)	453,621	495,082,712
盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	-	-	(77,708,120)
九十九年度淨利	-	-	-	-	161,605,009	161,605,009	-	-	161,605,009
採權益法認列股權比例變動之調整	-	(17,885)	-	-	-	-	-	(17,885)	(17,885)
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	(4,776,496)	-	(4,776,496)
員工行使認股權發行新股	7,372	73,721	171,103	-	-	-	-	-	244,824
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	(441,978)	(441,978)
採權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	-	-	97,646	156,852
九十九年十二月三十一日餘額	25,910,078	55,698,434	86,239,494	\$ 1,313,047	\$ 178,227,030	\$ 265,779,571	(\$ 6,543,163)	\$ 109,289	\$ 574,144,918

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)



董事長：



經理人：



會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
本年度淨利	\$ 161,605,009	\$ 89,217,836
調整項目		
折舊及攤銷	83,366,121	74,327,868
聯屬公司間未實現銷貨毛利	52,742	160,279
金融資產折溢價攤銷數	18,611	6,322
處分備供出售金融資產淨益	-	(37,370)
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	(16,091)
處分以成本衡量之金融資產損失	1,263	97
採權益法認列之投資淨損（益）	(7,111,443)	2,695,720
獲配採權益法被投資公司之現金股利	422,490	1,402,592
處分固定資產及其他資產淨損（益）	761,298	(138,613)
獲配股票作價賠償收入	(4,434,364)	-
遞延所得稅	(373,253)	(1,678,381)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資		
產及負債	189,577	(222,901)
應收關係人款項	(3,192,201)	(10,813,569)
應收票據及帳款	(2,366,385)	(8,443,344)
備抵呆帳	57,000	(5,746)
備抵退貨及折讓	(1,242,188)	2,715,050
其他應收關係人款項	85,830	235,470
其他金融資產	904,157	(392,317)
存 貨	(6,816,132)	(6,022,280)
預付費用及其他流動資產	(445,797)	290,470
應付帳款	624,608	4,925,758
應付關係人款項	535,108	836,992
應付所得稅	(1,652,251)	(461,691)
應付薪資及獎金	(3,389,548)	7,075,402
應付員工紅利及董事酬勞	4,188,131	(881,731)
應付費用及其他流動負債	265,241	1,259,544
應計退休金負債	17,425	97,167
遞延貸項	(47,873)	(230,487)
營業活動之淨現金流入	<u>222,023,176</u>	<u>155,902,046</u>

（接次頁）

(承 前 頁)

	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 182,335,032)	(\$ 86,970,843)
購買持有至到期日金融資產	-	(10,803,805)
採權益法之長期股權投資增加	(8,262,519)	(320,443)
購買以成本衡量之金融資產	(480)	(1,411)
處分備供出售金融資產價款	-	1,037,370
持有至到期日金融資產領回	15,943,000	6,293,000
處分以成本衡量之金融資產價款	3,370	18,828
被投資公司減資退回股款	-	27,753
處分固定資產及其他資產價款	387,735	71,850
遞延借項增加	(1,538,301)	(1,347,228)
存出保證金減少 (增加)	(5,940,633)	21,621
其他資產增加	(1,004,581)	-
投資活動之淨現金流出	(182,747,441)	(91,973,308)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	30,908,637	-
償還公司債	-	(8,000,000)
存入保證金減少	(253,489)	(477,776)
員工行使認股權發行新股	244,824	260,533
現金股利	(77,708,120)	(76,876,312)
融資活動之淨現金流出	(46,808,148)	(85,093,555)
現金及約當現金淨減少數	(7,532,413)	(21,164,817)
年初現金及約當現金餘額	117,043,543	138,208,360
年底現金及約當現金餘額	\$ 109,511,130	\$ 117,043,543
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 200,892	\$ 351,803
支付所得稅	\$ 9,640,396	\$ 7,791,196
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 195,950,918	\$ 108,592,471
應付工程及設備款增加	(13,491,140)	(21,620,819)
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)
支付現金金額	\$ 182,335,032	\$ 86,970,843

(接 次 頁)

(承前頁)

	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
處分固定資產及其他資產價款	\$ 1,872,880	\$ 64,390
其他應收關係人款項減少(增加)	(1,142,108)	8,269
其他金融資產款項增加	(218,291)	-
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)
取得現金金額	<u>\$ 387,735</u>	<u>\$ 71,850</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費 用及其他流動負債)	<u>\$ 718,637</u>	<u>\$ 769,144</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年六月三十日之資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年及九十九年六月三十日之財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日之經營成果與現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司民國一〇〇年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

台灣積體電路製造股份有限公司業已編製民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 七 月 二 十 五 日

單位：新台幣千元，惟
每股面額為元

代碼	資產	一〇〇年六月三十日	九十九年六月三十日	代碼	負債及股東權益	一〇〇年六月三十日	九十九年六月三十日
		金額	金額			金額	金額
		%	%			%	%
1100	現金及約當現金 (附註二及四)	13	20	2100	流動負債	4	3
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註二、五及三)	-	-	2180	短期借款 (附註十四)	-	-
1320	備供出售金融資產 (附註二、六及三)	1	-		公平價值變動列入損益之金融負債 (附註二、五及三)	-	-
1330	持有至到期日金融資產 (附註二、七及三)	-	-	2140	應付帳款	1	-
1150	應收票據及帳款 (附註三及二)	-	-	2150	應付關係人款項 (附註二及四)	1	-
1143	應收帳款 (附註三)	4	1	2160	應付所得稅 (附註二及十八)	1	-
1149	應收票據及帳款 (附註三)	3	4	2216	應付現金股利 (附註二十)	10	12
1148	備抵壞帳 (附註二及八)	-	-	2219	應付員工福利及董事酬勞 (附註二及二十)	-	-
1180	備抵退貨及折讓 (附註二及八)	-	-		應付工程及設備款	2	2
1190	其他應收關係人款項 (附註三及二)	-	-	2224	應付費用及其他流動負債 (附註十六及二)	5	4
1210	存貨 (附註二及九)	-	-	2170	應付利息及應付利息 (附註十五及二)	2	2
1286	遞延所得稅資產 (附註二及十八)	-	-	2271	一年內到期之應付公司債 (附註十五及二)	-	-
1298	預付費用及其他流動資產	-	-	21XX	流動負債合計	26	24
11XX	流動資產合計	24	32		流動負債合計	-	-
					長期負債	-	-
1421	長期投資 (附註二、六、七、十、十一及二)	15	17	2410	應付公司債 (附註十五及二)	-	1
1450	採權益法之長期股權投資	-	-	2440	其他長期應付款 (附註十六及二)	-	-
1460	備供出售金融資產	-	-	24XX	長期負債合計	-	-
1480	持有至到期日金融資產	-	-		其他負債	-	-
14XX	以成本衡量之金融資產	-	-	2810	應計退休基金負債 (附註二及十七)	-	1
	長期投資合計	15	18	2820	存入保證金 (附註二)	-	-
				28XX	其他負債合計	-	-
					負債合計	26	26
1521	不動產	19	19	2XXX	負債合計	-	-
1531	建築物	124	121		股本 (附註二十)	-	-
1561	機器設備	2	2	3110	普通股股本—每股面額 10 元	-	-
15X1	辦公設備	145	142		額定—28,050,000 股	-	-
15X9	累積折舊	(99)	(100)		發行—一〇〇年 25,914,283 股	-	-
1670	預付款項及未完工程	12	5		發行—九十九年 25,905,017 股	-	-
15XX	固定資產淨額	58	47		資本公積 (附註二及二十)	-	-
	固定資產合計	19	19	32XX	保留盈餘 (附註二十)	-	-
					法定盈餘公積	13	13
1760	無形資產	-	-	3310	特別盈餘公積	1	1
1780	商譽 (附註二)	-	-	3320	未分配盈餘	20	-
17XX	遞延稅項—淨額 (附註二及十三)	1	1	3350	保留盈餘合計	34	27
	無形資產合計	1	1	33XX	股東權益其他項目 (附註二及三)	-	-
					累積其他調整數	-	-
1860	遞延所得稅負債 (附註二及十八)	1	2	3420	金融商品未實現利益	-	-
1820	存出保證金	1	-	3450	股東權益其他項目合計	-	-
1880	其他 (附註二及四)	-	-	34XX	股東權益合計	-	-
18XX	其他資產合計	2	2	3XXX	負債及股東權益總計	100	100
1XXX	資產總計	100	100				

後附之附註係本財務報表之一部分。



會計主管：



經理人：



董事長：

台灣積體電路製造股份有限公司

損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年上半年度	九十九年上半年度
	金額 %	金額 %
4110 銷貨收入總額(附註二及二四)	\$ 212,301,752	\$ 196,370,319
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)	1,907,979	5,560,054
4100 銷貨收入淨額	210,393,773 100	190,810,265 100
5110 銷貨成本(附註九、十九及二四)	113,265,613 54	98,822,613 52
5910 銷貨毛利	97,128,160 46	91,987,652 48
5930 聯屬公司間已實現銷貨毛利 (附註二)	249,480 -	1,646 -
已實現銷貨毛利	97,377,640 46	91,989,298 48
營業費用(附註十九及二四)		
6300 研究發展費用	15,283,607 7	12,596,905 7
6200 管理費用	6,029,204 3	4,809,249 2
6100 行銷費用	1,211,366 1	1,358,880 1
6000 合計	22,524,177 11	18,765,034 10
6900 營業利益	74,853,463 35	73,224,264 38
營業外收入及利益		
7121 採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)	2,914,860 2	2,179,835 1
7480 和解賠償收入(附註二七)	433,425 -	1,278,400 1
7110 利息收入	402,293 -	388,318 -
7160 兌換淨益(附註二)	322,334 -	92,744 -
7480 技術服務收入(附註二四)	224,238 -	236,790 -
7310 金融商品評價淨益(附註 二、五及二三)	- -	29,739 -
7480 其他收入(附註二及二四)	461,096 -	169,924 -
7100 合計	4,758,246 2	4,375,750 2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	一 〇 〇 年 上 半 年 度			九 十 九 年 上 半 年 度								
	金	額	%	金	額	%						
營業外費用及損失												
7640	金融商品評價淨損（附註二、五及二三）			\$	197,255	-	\$	-	-			
7530	處分固定資產損失（附註二）				153,131	-		-	-			
7510	利息費用				146,374	-		79,188	-			
7880	災害損失（附註九）				-	-		194,137	-			
7880	其他損失				<u>122,232</u>	-		<u>76,974</u>	-			
7500	合 計				<u>618,992</u>	-		<u>350,299</u>	-			
7900	稅前利益				78,992,717	37		77,249,715	40			
8110	所得稅費用（附註二及十八）				<u>6,764,610</u>	<u>3</u>		<u>3,304,682</u>	<u>1</u>			
9600	本期淨利			\$	<u>72,228,107</u>	<u>34</u>	\$	<u>73,945,033</u>	<u>39</u>			
代 碼	稅 前			稅 後			稅 前			稅 後		
每股盈餘（附註二二）												
9750	基本每股盈餘			\$	<u>3.05</u>	\$	<u>2.79</u>	\$	<u>2.98</u>	\$	<u>2.85</u>	
9850	稀釋每股盈餘			\$	<u>3.05</u>	\$	<u>2.79</u>	\$	<u>2.98</u>	\$	<u>2.85</u>	

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



普 通 股	股 份 發 行	本 額	資 本 公 積	保 積	留 盈	盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	盈
-------	---------	-----	---------	-----	-----	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

後附之附註係本財務報表之一部分。



董事長：



經理人：



會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司

現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年 上半年度	九十九年 上半年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 72,228,107	\$ 73,945,033
調整項目		
折舊及攤銷	49,954,937	39,684,919
聯屬公司間已實現銷貨毛利	(249,480)	(1,646)
金融資產折溢價攤銷數	7,757	8,666
處分備供出售金融資產淨益	(35,151)	-
處分以成本衡量之金融資產損失	-	1,263
採權益法認列之投資淨益	(2,914,860)	(2,179,835)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,914,392	-
處分固定資產及其他資產淨損（益）	10,251	(9,334)
遞延所得稅	336,498	(990,530)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資 產及負債	(25,289)	355,343
應收關係人款項	(1,668,051)	(2,280,308)
應收票據及帳款	(1,546,839)	(7,377,040)
備抵呆帳	-	92,000
備抵退貨及折讓	(1,699,667)	(2,601,004)
其他應收關係人款項	(64,293)	33,182
其他金融資產	(5,588)	385,164
存 貨	(2,758,344)	(3,292,305)
預付費用及其他流動資產	284,243	(230,184)
應付帳款	(2,091,732)	492,889
應付關係人款項	811,641	1,178,788
應付所得稅	(1,032,551)	(5,276,124)
應付員工紅利及董事酬勞	4,900,168	5,006,322
應付費用及其他流動負債	(1,875,486)	(4,941,797)
應計退休金負債	35,858	(2,132)
遞延貸項	-	(47,873)
營業活動之淨現金流入	<u>114,516,521</u>	<u>91,953,457</u>

（接次頁）

(承前頁)

	一 〇 〇 年 上 半 年 度	九 十 九 年 上 半 年 度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$139,147,091)	(\$ 98,190,906)
採權益法之長期股權投資增加	(511,390)	(8,018,146)
購買以成本衡量之金融資產	-	(480)
處分備供出售金融資產價款	1,035,151	-
持有至到期日金融資產領回	2,675,000	11,595,000
處分以成本衡量之金融資產價款	-	3,370
處分固定資產及其他資產價款	2,068,298	20,903
遞延借項增加	(788,025)	(585,185)
存出保證金減少	3,841,898	316,659
其他資產增加	(22,600)	-
投資活動之淨現金流出	(130,848,759)	(94,858,785)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	2,232,244	17,759,356
存入保證金減少	(245,004)	(129,045)
員工行使認股權發行新股	131,354	85,614
融資活動之淨現金流入	2,118,594	17,715,925
現金及約當現金淨增加（減少）數	(14,213,644)	14,810,597
期初現金及約當現金餘額	109,511,130	117,043,543
期末現金及約當現金餘額	\$ 95,297,486	\$131,854,140
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 221,853	\$ 145,179
支付所得稅	\$ 7,417,035	\$ 9,452,574
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$133,768,114	\$ 94,612,614
應付工程及設備款減少	5,379,459	3,701,212
換出資產抵減價款	(482)	(122,920)
支付現金金額	\$139,147,091	\$ 98,190,906
處分固定資產及其他資產價款	\$ 2,905,302	\$ 143,823
其他應收關係人款項增加	(836,522)	-
換出資產抵減價款	(482)	(122,920)
取得現金金額	\$ 2,068,298	\$ 20,903

(接次頁)

(承前頁)

	一 〇 〇 年 上 半 年 度	九 十 九 年 上 半 年 度
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	<u>\$ 4,500,000</u>	<u>\$ -</u>
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付 費用及其他流動負債)	<u>\$ 897,298</u>	<u>\$ 569,149</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如財務報表附註三所述，台灣積體電路製造股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

會計師 黃 樹 傑

林 鴻 鵬



黃 樹 傑



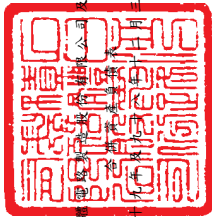
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 一 月 二 十 四 日



台灣積體電路股份有限公司及子公司

中華民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股面額為元

代 碼	資 產	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日		九 十 八 年 十 二 月 三 十 一 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
1100 1310 1320 1330 1150 1143 1149 1148 1180 1190 1210 1286 11XX	流動資產						流動負債				
	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 147,886,955	20	\$ 171,276,341	29	2100	短期借款(附註十五)	\$ 31,213,944	4	\$ -	-
	公平價值變動列入損益之金融資產(附註二、五及二五)	6,886	-	186,081	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債(附註二、五及二五)	19,002	-	25	-
	備供出售金融資產(附註二、六及二五)	28,883,728	4	14,389,946	2	2200	遞延之衍生性金融負債(附註二、十一及二五)	814	-	-	-
	持有至到期日金融資產(附註二、七及二五)	4,796,589	1	9,944,843	2	2140	應付帳款	12,104,173	2	10,905,884	-
	應收關係人款項	2,722	-	12,524	-	2150	應付關係人款項(附註二六)	867,085	-	783,007	-
	應收票據及帳款	51,029,885	7	44,637,642	7	2160	應付所得稅(附註二及二十)	7,184,697	1	8,800,249	-
	備抵呆帳(附註二及八)	(504,029)	-	(543,325)	-	2171	應付薪資及獎金	6,424,064	1	9,317,035	2
	備抵退貨及折讓(附註二及八)	(7,546,264)	(1)	(8,724,481)	(1)	2219	應付員工福利及董監酬勞(附註二及二二)	11,096,147	2	6,818,343	-
	其他應收關係人款項(附註二六)	124,586	-	121,292	-	2224	應付工薪及設備款	43,259,857	6	28,924,265	5
	其他金融資產(附註二七)	1,021,552	-	1,849,987	-	2170	應付費用及其他流動負債(附註十八、二五及二九)	10,779,923	1	12,635,182	2
	存貨(附註二、三及九)	28,405,984	4	20,913,751	4	2272	一年內到期之長期銀行借款(附註十七、二五及二七)	241,407	-	949,298	-
	遞延所得稅資產(附註二及二十)	5,373,076	1	4,370,309	1	21XX	流動負債合計	123,191,113	17	79,133,288	13
1421 1450 1460 1480 14XX	預付費用及其他流動資產	2,037,647	-	1,369,838	-		長期負債				
	流動資產合計	261,519,317	36	259,803,748	44		應付公司債(附註十六及二五)	4,500,000	1	4,500,000	1
	長期投資(附註二、六、七、十、十二及二五)						長期銀行借款(附註十七、二五及二七)	301,561	-	578,560	-
	採權益法之長期股權投資	25,815,385	4	17,871,208	3		其他長期應付款(附註十八、二五及二九)	6,554,208	1	5,602,420	1
	備供出售金融資產	1,033,049	-	1,353,242	-		應付買款(附註二、十三及二五)	694,986	-	707,499	-
1511 1521 1531 1561 1611 15X1 15X9 1670 15XX	持有至到期日金融資產	8,502,887	1	3,063,004	-		長期負債合計	12,050,755	2	11,388,479	2
	以成本衡量之金融資產	4,429,207	1	37,845,503	2		其他負債				
	長期投資合計	39,775,528	6				應計退休金負債(附註二及十九)	3,812,351	1	3,797,032	1
	成本						存入保證金(附註二九)	789,098	-	1,006,023	-
	土地及土地改良	891,197	-	934,090	-		遞延所得稅	126,539	-	185,689	-
1760 1780 17XX	建築物	145,966,024	20	142,294,558	24		其他	254,643	-	137,161	-
	機器設備	913,155,252	127	775,653,489	130		其他負債合計	4,982,631	-	5,125,905	-
	辦公設備	14,856,582	2	13,697,747	2		負債合計	140,224,499	20	95,647,672	16
	租賃資產	701,552	-	714,424	-		股本(附註二二)				
	累積折舊	1,075,570,607	(149)	(933,264,308)	(156)		額定—25,050,000 仟股				
1860 1820 1880 18XX	預付款項及未完工程	(773,278,157)	(117)	(693,743,886)	(117)		發行—九十九年 25,910,078 仟股				
	固定資產淨額	86,151,573	12	34,154,365	6		九十八年 25,902,706 仟股				
	無形資產	388,444,023	54	273,674,787	45		資本公積(附註二及二二)	259,100,787	36	259,027,066	43
	商譽(附註二)	5,704,897	1	5,931,318	1		保留盈餘(附註二二)	55,698,434	8	55,486,010	9
	遞延借項—淨額(附註二及十四)	6,027,085	1	6,458,554	1		法定盈餘公積	86,239,494	12	77,317,710	13
1860 1820 1880 18XX	無形資產合計	11,731,982	2	12,389,872	2		特別盈餘公積	1,313,047	-	-	-
	其他資產						未分配盈餘	178,227,030	24	104,564,972	18
	遞延所得稅資產(附註二及二十)	7,362,784	1	7,988,303	1		保留盈餘合計	265,779,571	36	181,882,682	31
	存出保證金	8,677,970	1	2,733,143	1		股東權益其他項目(附註二、十一及二五)	(6,543,163)	(1)	(1,766,667)	-
	其他(附註二及二七)	1,417,300	-	260,864	-		金融商品未實現利得	109,289	-	453,621	-
1XXX	其他資產合計	17,458,054	2	10,982,310	2		股東權益其他項目合計	(6,433,874)	(1)	(1,313,046)	-
	資產總計	\$ 718,928,904	100	\$ 594,696,220	100		母公司股東權益合計	574,144,918	79	495,082,712	83
							少數股權(附註二)	4,559,487	1	3,965,836	1
							股東權益合計	578,704,405	80	499,048,548	84
							負債及股東權益總計	\$ 718,928,904	100	\$ 594,696,220	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱動態票信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：

經理人：

會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	金 額 %	金 額 %
4110 銷貨收入總額(附註二及二六)	\$ 431,630,858	\$ 309,655,614
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)	12,092,947	13,913,375
4100 銷貨收入淨額	419,537,911 100	295,742,239 100
5110 銷貨成本(附註三、九、二一及二六)	212,484,320 51	166,413,628 56
5910 銷貨毛利	207,053,591 49	129,328,611 44
營業費用(附註二一及二六)		
6300 研究發展費用	29,706,662 7	21,593,398 7
6200 管理費用	12,803,997 3	11,285,478 4
6100 行銷費用	5,367,597 1	4,487,849 2
6000 合 計	47,878,256 11	37,366,725 13
6900 營業利益	159,175,335 38	91,961,886 31
營業外收入及利益		
7480 和解賠償收入(附註二九)	6,939,764 2	1,464,915 1
7121 採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)	2,298,159 1	45,994 -
7110 利息收入	1,665,193 -	2,600,925 1
7140 處分金融資產淨益(附註 二及二五)	736,843 -	15,999 -
7480 技術服務收入(附註二六 及二九)	450,503 -	367,013 -
7310 金融商品評價淨益(附註 二、五及二五)	320,730 -	594,660 -
7480 其他收入(附註二及二六)	724,880 -	564,042 -
7100 合 計	13,136,072 3	5,653,548 2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業外費用及損失				
7530	處分固定資產損失 (附註二)	\$ 849,254	-	\$ -	-
7510	利息費用	425,356	-	391,479	-
7880	災害損失 (附註九)	190,992	-	-	-
7630	金融資產減損損失 (附註二、六、十二及二五)	159,798	-	913,230	1
7560	兌換淨損 (附註二)	99,130	-	626,971	-
7880	其他損失 (附註二)	<u>316,482</u>	<u>-</u>	<u>221,107</u>	<u>-</u>
7500	合 計	<u>2,041,012</u>	<u>-</u>	<u>2,152,787</u>	<u>1</u>
7900	稅前利益	170,270,395	41	95,462,647	32
8110	所得稅費用 (附註二及二十)	<u>7,988,465</u>	<u>2</u>	<u>5,996,424</u>	<u>2</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>	<u>\$ 89,466,223</u>	<u>30</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 161,605,009	39	\$ 89,217,836	30
9602	少數股權	<u>676,921</u>	<u>-</u>	<u>248,387</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 162,281,930</u>	<u>39</u>	<u>\$ 89,466,223</u>	<u>30</u>
代 碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘 (附註二四)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.24</u>	<u>\$ 3.68</u>	<u>\$ 3.45</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 6.54</u>	<u>\$ 6.23</u>	<u>\$ 3.67</u>	<u>\$ 3.44</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



此印为《说文解字》作者许慎所用之印。印文为“许慎之印”。



後附之附註係本合併財務報表之一部分。



台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月二日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$161,605,009	\$ 89,217,836
歸屬予少數股權之淨利	676,921	248,387
調整項目		
折舊及攤銷	87,810,103	80,814,748
金融資產折溢價攤銷數	34,142	21,483
金融資產減損損失	159,798	913,230
處分備供出售金融資產淨損（益）	(603,368)	20,337
持有至到期日金融資產被贖回利益	-	(16,091)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(133,475)	(20,245)
採權益法認列之投資淨益	(2,298,159)	(45,994)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	320,002	1,239,490
處分固定資產及其他資產淨損（益）	633,230	(45,475)
獲配股票作價賠償收入	(4,434,364)	-
提列閒置資產損失	319	-
遞延所得稅	(377,248)	(1,752,409)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資產及負債	198,172	(215,513)
應收關係人款項	9,802	(12,117)
應收票據及帳款	(6,392,243)	(19,614,321)
備抵呆帳	(39,296)	87,574
備抵退貨及折讓	(1,178,217)	2,653,455
其他應收關係人款項	(3,294)	(21,374)
其他金融資產	740,959	7,834
存貨	(7,492,233)	(6,037,106)
預付費用及其他流動資產	(752,408)	585,430
應付帳款	933,894	4,916,885
應付關係人款項	84,078	293,150
應付所得稅	(1,615,552)	(531,576)
應付薪資及獎金	(2,892,971)	7,101,255
應付員工紅利及董監酬勞	4,277,804	(1,056,399)
應付費用及其他流動負債	248,192	1,356,269

（接次頁）

(承 前 頁)

	九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
應計退休金負債	\$ 15,319	\$ 95,448
遞延貸項	(59,150)	(237,726)
營業活動之淨現金流入	<u>229,475,766</u>	<u>159,966,465</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(186,944,203)	(87,784,906)
購買備供出售金融資產	(48,340,334)	(38,800,577)
購買持有至到期日金融資產	(4,101,501)	(12,224,353)
採權益法之長期股權投資增加	(6,242,350)	(42,947)
購買以成本衡量之金融資產	(1,812,928)	(321,195)
處分備供出售金融資產價款	37,816,288	36,039,978
持有至到期日金融資產領回	15,943,000	7,944,800
處分以成本衡量之金融資產價款	242,335	131,075
處分固定資產及其他資產價款	115,524	24,241
遞延借項增加	(1,801,728)	(1,469,831)
存出保證金減少 (增加)	(5,944,827)	34,056
其他資產減少 (增加)	(1,015,458)	1,176
投資活動之淨現金流出	<u>(202,086,182)</u>	<u>(96,468,483)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	31,213,944	-
舉借長期借款	-	286,574
償還長期借款	(967,034)	(378,673)
償還公司債	-	(8,000,000)
其他長期應付款減少	(1,107,333)	-
存入保證金減少	(232,925)	(478,472)
受領贈與	49,021	-
員工行使認股權發行新股	244,824	260,533
現金股利	(77,708,120)	(76,876,312)
少數股權減少	(130,083)	(284,774)
融資活動之淨現金流出	<u>(48,637,706)</u>	<u>(85,471,124)</u>
現金及約當現金淨減少數	(21,248,122)	(21,973,142)
匯率影響數	(2,141,264)	(1,364,269)
年初現金及約當現金餘額	<u>171,276,341</u>	<u>194,613,752</u>
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 147,886,955</u>	<u>\$ 171,276,341</u>

(接 次 頁)

(承前頁)

	九十九年度	九十八年度
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 392,805	\$ 580,376
支付所得稅	\$ 9,818,418	\$ 8,088,124
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 201,696,476	\$ 109,151,226
應付工程及設備款增加	(14,599,987)	(21,361,340)
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)
其他負債增加	(27,540)	-
應付租賃款增加	-	(4,171)
支付現金金額	\$ 186,944,203	\$ 87,784,906
購買備供出售金融資產價款	\$ 48,405,875	\$ 38,800,577
應付費用及其他流動負債增加	(65,541)	-
支付現金金額	\$ 48,340,334	\$ 38,800,577
處分固定資產及其他資產價款	\$ 458,561	\$ 25,050
其他金融資產增加	(218,291)	-
換出資產抵減價款	(124,746)	(809)
取得現金金額	\$ 115,524	\$ 24,241
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 241,407	\$ 949,298
一年內到期之其他長期應付款(帳列應付費用及其他流動負債)	\$ 1,406,601	\$ 4,005,307

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年一月二十四日查核報告)

董事長：



經理人：



會計主管：



會計師查核報告

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年六月三十日之合併資產負債表，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達台灣積體電路製造股份有限公司及子公司民國一〇〇年及九十九年六月三十日之合併財務狀況，暨民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 樹 傑

黃 樹 傑



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 七 月 二 十 五 日

代碼	資產	金額	%	九十九年六月三十日	金額	%	一〇〇年六月三十日	金額	%
1100	流動資產								
1130	現金及當現金 (附註二及四)	\$ 150,978,778	19	\$ 172,486,218	25	2100	短期應收 (附註十五)	\$ 33,140,881	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 (附註二、五及二五)	-	-	-	-	2180	公平價值變動列入損益之金融負債 (附註二、五及二五)	15,052	-
1320	備有至到期日金融資產 (附註二、六及二五)	19,781	479	27,024,422	4	2200	遞延之衍生性金融負債 (附註二、十一及二五)	448	-
1330	應收關聯人款項	5,208,149	1	7,031,587	1	2140	應付帳款	11,710,578	1
1150	應收票據及帳款 (附註三)	2,367	30,800	54,791,750	8	2150	應付關聯人款項 (附註二六)	1,542,011	-
1143	應收票據及帳款 (附註三)	52,491,604	7	()	-	2160	應付所得稅 (附註二及二五)	6,104,840	1
1149	應收票據及帳款 (附註三、三及八)	()	()	()	()	2216	應付關聯人款項 (附註二及二五)	78,127,227	10
1180	其他應收關聯人款項 (附註三及二六)	()	()	6,162,562	-	2219	應付員工福利及董事酬勞 (附註二及二五)	15,999,671	2
1148	其他應收關聯人款項 (附註三及二六)	999,772	-	495,804	-	2224	應付工程及設備款	36,805,112	5
1190	其他金融資產 (附註二七)	1,054,744	-	1,473,377	-	2170	應付費用及其他流動負債 (附註二八、二五及二九)	17,543,781	2
1210	存貨 (附註二九)	31,523,206	4	24,799,896	4	2271	一年內到期之應付公司債及長期銀行借款 (附註二六、二七、二五及二七)	4,500,000	1
1286	遞延所得稅資產 - 淨額 (附註二及二五)	1,173,462	1	3,394,104	1	21XX	流動負債合計	205,488,601	26
1286	預付費用及其他流動資產	2,481,073	-	1,846,918	-				
11XX	流動資產合計	242,551,808	31	286,614,852	42				
1421	長期投資 (附註二、六、七、十、十二及二五)	23,357,209	3	24,598,350	4				
1421	按權益法之長期股权投资	-	-	1,039,916	-	2410	應付公司債 (附註二六及二五)	-	-
1450	備供出售金融資產	-	-	10,757,937	1	2421	長期銀行借款 (附註二七、二五及二七)	1,500,000	-
1460	持有至到期日金融資產	7,311,037	1	4,565,416	1	2440	其他長期應付款 (附註二八、二五及二九)	3,040,747	1
1480	以成本衡量的金融資產	4,176,134	1	40,951,619	6	2446	應付利息 (附註二、十三及二五)	670,855	-
14XX	長期投資合計	34,844,380	5	40,951,619	6	24XX	長期負債合計	5,211,612	1
	固定資產 (附註二、十三、二六及二七)								
	成本								
1501	土地及土地改良	1,501,628	-	940,536	-	2810	應計退休金負債 (附註二及二九)	3,847,450	-
1521	建築物	166,481,044	22	144,574,839	22	2820	存入保證金 (附註二九)	521,598	-
1531	機器設備	1,012,617,056	129	865,253,621	107	2881	遞延所得稅	30,530	-
1561	辦公設備	15,976,394	2	14,427,983	2	2888	其他	353,357	-
1611	租賃資產	677,086	-	724,579	-	28XX	其他負債合計	4,752,935	-
15X1	累積折舊	1,197,253,208	153	1,025,921,538	121				
539	預付款項及未完工程	()	()	()	()	2XX	負債合計	215,453,148	27
670	累計折舊	819,490,993	()	()	()				
5XX	固定資產合計	100,125,197	13	36,993,851	5				
		477,887,412	61	328,470,326	48				
	無形資產					3110	股本 (附註二二)	-	-
760	商譽 (附註二)	5,487,060	-	5,965,104	1		普通股股本 - 每股面額 10 元	-	-
780	遞延所得稅 - 淨額 (附註二及二四)	5,690,862	1	6,162,111	1		期定 - 28,050,000 元	-	-
7XX	無形資產合計	11,177,922	1	12,127,215	2		發行 - 一〇〇年 25,914,283 元	-	-
							九十九年 25,905,017 元	-	-
						32XX	資本公積 (附註二及二二)	259,142,831	33
							保留盈餘 (附註二二)	55,802,387	7
						3310	法定盈餘公積	102,399,995	13
						3320	特別盈餘公積	6,433,874	1
860	遞延所得稅負債 (附註二及二五)	11,092,048	1	9,820,064	2	3350	未分配盈餘	151,443,573	19
880	存出保證金	4,834,381	1	2,419,820	-	33XX	保留盈餘合計	260,227,442	33
880	其他 (附註二及二七)	1,422,662	-	361,696	-		股東權益其他項目 (附註二、十一及二五)	-	-
8XX	其他資產合計	17,354,091	2	12,601,580	2	3420	其他調整數	(11,461,047)	(1)
						3450	金融商品未實現利得	187,908	-
						34XX	股東權益其他項目合計	(11,273,139)	(1)
							母公司股東權益合計	563,949,521	72
						3610	少數股權 (附註二)	4,412,944	1
						3XX	股東權益合計	566,362,465	73
							負債及股東權益總計	\$ 783,815,613	100

查附之附註係奉令併財務報表之一部分。

會計主管：

經理人：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇〇年上半年度			九十九年上半年度		
	金	額	%	金	額	%
4110 銷貨收入總額(附註二及二六)	\$	217,895,876		\$	202,881,161	
4170 銷貨退回及折讓(附註二及八)		2,010,014			5,732,158	
4100 銷貨收入淨額		215,885,862	100		197,149,003	100
5110 銷貨成本(附註九、二一及二六)		113,359,191	52		101,037,403	51
5910 銷貨毛利		102,526,671	48		96,111,600	49
營業費用(附註二一及二六)						
6300 研究發展費用		16,456,677	8		13,599,891	7
6200 管理費用		6,781,342	3		5,403,158	3
6100 行銷費用		2,259,365	1		2,512,196	1
6000 合計		25,497,384	12		21,515,245	11
6900 營業利益		77,029,287	36		74,596,355	38
營業外收入及利益						
7110 利息收入		780,503	1		831,500	1
7121 採權益法認列之投資淨益 (附註二及十)		765,485	-		706,236	-
7480 和解賠償收入(附註二九)		433,425	-		1,278,400	1
7160 兌換淨益(附註二)		419,535	-		101,313	-
7480 技術服務收入(附註二六 及二九)		224,372	-		241,884	-
7130 處分固定及其他資產利益 (附註二及二六)		189,020	-		92,288	-
7140 處分金融資產淨益(附註 二及二五)		145,908	-		202,114	-
7310 金融商品評價淨益(附註 二、五及二五)		-	-		20,468	-
7480 其他收入(附註二)		383,128	1		287,693	-
7100 合計		3,341,376	2		3,761,896	2

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一 〇 〇 年 上 半 年 度			九 十 九 年 上 半 年 度		
		金	額	%	金	額	%
	營業外費用及損失						
7640	金融商品評價淨損 (附註二、五及二五)	\$	280,630	1	\$	-	-
7510	利息費用		243,261	-		184,947	-
7530	處分固定資產損失 (附註二)		156,761	-		943	-
7630	閒置資產減損損失 (附註二)		58,478	-		319	-
7630	金融資產減損損失 (附註二、十二及二五)		58,096	-		112,313	-
7880	災害損失 (附註九)		-	-		194,137	-
7880	其他損失 (附註二)		206,318	-		152,685	-
7500	合 計		<u>1,003,544</u>	<u>1</u>		<u>645,344</u>	<u>-</u>
7900	稅前利益		79,367,119	37		77,712,907	40
8110	所得稅費用 (附註二及二十)		<u>6,911,828</u>	<u>3</u>		<u>3,421,357</u>	<u>2</u>
9600	合併總淨利	\$	<u>72,455,291</u>	<u>34</u>	\$	<u>74,291,550</u>	<u>38</u>
	歸屬予：						
9601	母公司股東	\$	72,228,107	34	\$	73,945,033	38
9602	少數股權		<u>227,184</u>	<u>-</u>		<u>346,517</u>	<u>-</u>
		\$	<u>72,455,291</u>	<u>34</u>	\$	<u>74,291,550</u>	<u>38</u>
代 碼		稅 前		稅 後	稅 前		稅 後
		稅	後		稅	後	
	每股盈餘 (附註二四)						
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>		<u>\$ 2.99</u>	<u>\$ 2.85</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 3.05</u>	<u>\$ 2.79</u>		<u>\$ 2.98</u>	<u>\$ 2.85</u>	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

台湾林德气体股份有限公司及子公司

合 作 出 版 社 出 版

民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日

100

普通股發行股本	資本公積	保留	盈餘	股東權益其他項目	母公司股東權益合計	股東權益合計
股數(千股)	金額	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	少數股東權益
25,910,078	\$ 259,100,787	\$ 86,239,494	\$ 1,313,047	\$ 178,227,030	(\$ 6,543,163)	\$ 4,559,487
盈餘分配						\$ 578,704,405
法定盈餘公積	-	16,160,501	-	(16,160,501)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	5,120,827	(5,120,827)	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	(77,730,236)	(77,730,236)	(77,730,236)
-〇〇年上半年度合併總淨利	-	-	-	72,228,107	-	72,228,107
換權益法認列股權比例變動之調整	-	-	-	-	-	227,184
累積換算調整數	-	14,643	-	-	-	(11,995)
員工行使認股權發行新股	4,205	89,310	-	-	(4,917,884)	18,400
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-
換權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	-	95,888
現金流量風險迴避未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	(17,419)	-
少數股權減少	-	-	-	-	150	216
-〇〇年六月三十日餘額	25,914,283	\$ 55,802,387	\$ 6,433,874	\$ 151,443,573	(\$ 11,461,047)	\$ 4,417,944
九十九年一月一日餘額	25,902,706	\$ 55,486,010	\$ -	\$ 104,564,972	(\$ 1,766,667)	\$ 3,965,836
盈餘分配						\$ 499,048,548
法定盈餘公積	-	8,921,784	-	(8,921,784)	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	1,313,047	(1,313,047)	-	-
現金股利—每股 3.00 元	-	-	-	(77,708,120)	(77,708,120)	(77,708,120)
九十九年上半年度合併總淨利	-	-	-	73,945,033	-	73,945,033
換權益法認列股權比例變動之調整	-	-	-	-	-	346,517
累積換算調整數	-	711	-	-	-	1,063
員工行使認股權發行新股	2,311	62,508	-	-	732,411	(6,137)
備供出售金融資產評價損益之淨變動數	-	-	-	-	-	-
換權益法認列被投資公司股權淨值之淨變動	-	-	-	-	501,091	15,894
現金流量風險迴避未實現損益之淨變動數	-	-	-	-	27,478	31,702
少數股權減少	-	-	-	-	(312)	(449)
九十九年六月三十日餘額	25,905,017	\$ 55,566,895	\$ 1,313,047	\$ 90,567,054	(\$ 1,034,256)	\$ 4,188,353
九十九年六月三十日餘額	25,910,078	\$ 259,050,172	\$ 86,239,494	\$ 178,119,595	(\$ 1,034,256)	\$ 4,559,487
九十九年六月三十日餘額	25,910,078	\$ 259,100,787	\$ 86,239,494	\$ 178,227,030	(\$ 6,543,163)	\$ 578,704,405

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

代理人：

會計主管：

台灣積體電路製造股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇〇年及九十九年一月一日至六月三十日

單位：新台幣仟元

	一〇〇年 上半年度	九十九年 上半年度
營業活動之現金流量：		
歸屬予母公司股東之淨利	\$ 72,228,107	\$ 73,945,033
歸屬予少數股權之淨利	227,184	346,517
調整項目		
折舊及攤銷	51,974,504	42,133,803
金融資產折溢價攤銷數	15,015	15,974
金融資產減損損失	58,096	112,313
處分備供出售金融資產淨益	(126,488)	(117,487)
處分以成本衡量之金融資產淨益	(19,420)	(84,627)
採權益法認列之投資淨益	(765,485)	(706,236)
獲配採權益法被投資公司之現金股利	1,914,392	-
處分固定資產及其他資產淨益	(32,259)	(91,345)
提列閒置資產減損損失	58,478	319
遞延所得稅	427,314	(855,556)
營業資產及負債之淨變動：		
公平價值變動列入損益之金融資 產及負債	(16,845)	362,386
應收關係人款項	355	(18,276)
應收票據及帳款	(1,461,719)	(10,154,108)
備抵呆帳	(10,029)	54,616
備抵退貨及折讓	(1,734,312)	(2,561,919)
其他應收關係人款項	(79,870)	(55,607)
其他金融資產	57,357	332,211
存貨	(3,117,222)	(3,886,145)
預付費用及其他流動資產	(443,426)	(564,147)
應付帳款	(2,075,757)	1,058,991
應付關係人款項	674,926	531,538
應付所得稅	(1,079,857)	(5,279,149)
應付員工紅利及董監酬勞	4,903,524	5,079,128
應付費用及其他流動負債	(1,974,219)	(4,588,051)
應計退休金負債	35,099	(3,316)
遞延貸項	(96,009)	(46,922)
營業活動之淨現金流入	<u>119,541,434</u>	<u>94,959,938</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年 上半年度	九十九年 上半年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(\$ 146,142,855)	(\$ 98,857,482)
購買備供出售金融資產	(34,726,013)	(32,605,392)
購買持有至到期日金融資產	-	(3,829,368)
採權益法之長期股權投資增加	-	(6,242,350)
購買以成本衡量之金融資產	(123,159)	(1,722,949)
處分備供出售金融資產價款	58,501,445	21,375,053
持有至到期日金融資產領回	2,675,000	11,595,000
處分以成本衡量之金融資產價款	207,333	180,494
處分固定資產及其他資產價款	551,208	112,142
遞延借項增加	(823,351)	(801,055)
存出保證金減少	3,843,589	313,323
其他資產減少(增加)	13,094	(14,996)
投資活動之淨現金流出	(116,023,709)	(110,497,580)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	1,926,937	18,082,602
舉借長期借款	2,100,000	-
償還長期借款	(1,142,968)	(221,035)
其他長期應付款減少	(890,000)	(1,113,193)
存入保證金減少	(267,500)	(128,394)
受領贈與	-	49,021
員工行使認股權發行新股	131,354	85,614
少數股權增加	18,601	18,039
融資活動之淨現金流入	1,876,424	16,772,654
現金及約當現金淨增加數	5,394,149	1,235,012
匯率影響數	(2,302,326)	(25,135)
期初現金及約當現金餘額	147,886,955	171,276,341
期末現金及約當現金餘額	\$ 150,978,778	\$ 172,486,218
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	\$ 307,448	\$ 241,794
支付所得稅	\$ 7,605,291	\$ 9,556,350

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇年 上半年度	九十九年 上半年度
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產價款	\$ 141,371,625	\$ 95,565,097
應付工程及設備款減少	4,772,583	3,415,305
換出資產抵減價款	(1,353)	(122,920)
支付現金金額	<u>\$ 146,142,855</u>	<u>\$ 98,857,482</u>
處分固定資產及其他資產價款	\$ 552,561	\$ 235,062
換出資產抵減價款	(1,353)	(122,920)
取得現金金額	<u>\$ 551,208</u>	<u>\$ 112,142</u>
購買備供出售金融資產價款	\$ 34,662,414	\$ 32,630,717
應付費用及其他流動負債增加	63,599	(25,325)
支付現金金額	<u>\$ 34,726,013</u>	<u>\$ 32,605,392</u>
處分備供出售金融資產價款	\$ 58,591,994	\$ 21,375,053
其他金融資產增加	(90,549)	-
取得現金金額	<u>\$ 58,501,445</u>	<u>\$ 21,375,053</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之應付公司債	\$ 4,500,000	\$ -
一年內到期之長期銀行借款	\$ -	\$ 889,275
一年內到期之其他長期應付款（帳列應付 費用及其他流動負債）	<u>\$ 3,916,796</u>	<u>\$ 1,301,510</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



中華信用評等股份有限公司 函

受文者：台灣積體電路製造股份有限公司

發文日期：中華民國一百年十二月六日

發文字號：（一百）信評字第 537 號

附件：如文

主旨：檢送 貴公司公司債信用評等結果如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司依據 貴公司之委託暨所提供之資訊，業已完成對 貴公司公司債之信用評等服務。茲評定 貴公司擬發行 100 年度第 2 期之債務評等如下：

債券種類	無擔保普通公司債	無擔保普通公司債
年期	5 年期	7 年期
金額	新台幣 100 億元	新台幣 70 億元
評等	twAAA	twAAA

另 貴公司長期發行人信用評等等級仍為 twAAA，短期發行人信用評等等級仍為 twA-1+，評等展望則為穩定(Stable)。

- 二、本公司所提供之信用評等，係依據 貴公司提供之一切資訊，以及其他本公司認為可靠之來源所取得之相關資訊。本公司之信用評等並非為稽核或保證，且有時須使用未經查核或簽證之財務資料；上開評等等級，得因所依據資訊之變更、無法取得或其他類似情形而予以撤回或變更。又本公司並未擔任任何公司或個人之顧問或信託關係之受託人；此外，本公司對於因評等結果或評等報告所衍生之任何損失，不負擔賠償責任。
- 三、本公司之信用評等與嗣後之監視過程皆繫於評等過程中 貴公司及 貴公司之會計師、顧問及其他專家提供資訊之正確性與完整性。此外，本公司之信用評等並非對任何發行公司金融商品之購買、出售、或持有之推薦，亦非對任何有價證券之市場價格或任何特定投資人提供意見。
- 四、本公司並未同意且將來亦不會同意擔任 貴公司或任何第三人以本公司之評等報告作為募集與發行有價證券或其他用途時，依證券相關法規規定所指稱之專家。



正本：台灣積體電路製造股份有限公司

副本：企業評等部、管理暨財務部

台灣積體電路製造股份有限公司

董事會會議記錄

(中華民國一百零一年度第三次董事常會)

(節錄本)

時間： 壹、中華民國一百零一年八月八日下午四點
貳、中華民國一百零一年八月九日上午八點

地點： 新竹科學工業園區新竹市力行六路八號

親自出席董事共九人： 張忠謀、曾繁城、Peter L. Bonfield、施振榮、
Thomas J. Engibous、鄒至莊、陳國慈、李鍾熙、
蔡力行

主席： 張忠謀 博士

記錄： 方淑華

列席人員： (略)

- 一、 核可中華民國一百零一年五月九日及十日董事會會議記錄：全體出席董事一致同意通過上述會議記錄。
- 二、 董事長簡評
- 三、 內部稽核報告
- 四、 審計委員會主席報告 (略)
- 五、 薪酬委員會主席報告 (略)
- 六、 經營團隊報告 (略)
- 七、 決議事項
 - 第一項： (略)
 - 第二項： (略)

第三項：提請本會核准於不高於新台幣 35,000,000,000 元之額度內（按美金對新台幣匯率 1：28.7 計算，折合美金約 1,220,000,000 元）於國內市場募集無擔保普通公司債以籌集長期低固定利率資金，並核准就本公司債向主管機關申請發行，並於台灣證券櫃檯買賣中心上櫃交易；另請授權董事長決定上述公司債之主要條款及發行時間。

經提案表決全體出席董事一致通過決議如下：

決議：照案通過。

第四項：（略）

第五項：（略）

第六項：（略）

第七項：（略）

第八項：（略）

第九項：（略）

第十項：（略）

一、經詢無其他臨時動議，本會議程結束。

台灣積體電路製造股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

台灣積體電路製造股份有限公司本次為募集發行一〇〇年度第二期無擔保普通公司債，發行總額為新臺幣壹佰柒拾億元整，依發行期限不同分為甲類及乙類，甲類五年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣壹佰億元整，乙類七年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣柒拾億元整，票面金額均為新臺幣壹仟萬元整，向行政院金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，台灣積體電路製造股份有限公司本次向行政院金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此 致

台灣積體電路製造股份有限公司

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬



中 華 民 國 一 〇 〇 年 十 二 月 十 六 日

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長：張忠謀

